

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 2003年 6月16日  
Date of Application:

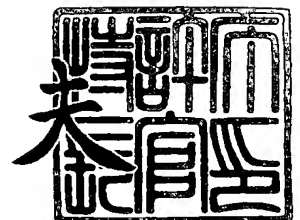
出願番号 特願2003-171195  
Application Number:  
[ST. 10/C]: [JP 2003-171195]

出願人 セイコーエプソン株式会社  
Applicant(s):

2003年11月21日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今井 康



【書類名】 特許願

【整理番号】 P2317EP

【提出日】 平成15年 6月16日

【あて先】 特許庁長官 殿

【国際特許分類】 H03H 9/00

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 宮崎 克彦

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 小山 裕吾

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 下平 和彦

【発明者】

【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内

【氏名】 中島 ゆかり

【特許出願人】

【識別番号】 000002369

【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社

【代理人】

【識別番号】 100091306

【弁理士】

【氏名又は名称】 村上 友一

## 【選任した代理人】

【識別番号】 100086922

【弁理士】

【氏名又は名称】 大久保 操

## 【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2002-358392

【出願日】 平成14年12月10日

## 【先の出願に基づく優先権主張】

【出願番号】 特願2003-106598

【出願日】 平成15年 4月10日

## 【手数料の表示】

【予納台帳番号】 002196

【納付金額】 21,000円

## 【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 0015139

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 圧電発振器およびその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 2 枚のリードフレームで構成される積層リードフレームにつき、圧電振動子との接続用リードを一方側の前記リードフレームに形成し、前記接続用リードを前記一方側に立ち上げて接続端子を形成するとともに、実装基板への実装用リードを他方側の前記リードフレームに形成し、前記実装用リードを前記他方側に立ち上げて実装端子を形成し、

発振回路を形成した IC を、前記積層リードフレームに実装し、

パッケージの内部に圧電振動片を封止した前記圧電振動子を、前記積層リードフレームに実装し、

前記実装端子の主面を外部に露出させつつ、前記積層リードフレームおよび前記圧電振動子を樹脂パッケージの内部に封止して形成したことを特徴とする圧電発振器。

【請求項 2】 2 枚のリードフレームで構成される積層リードフレームにつき、圧電振動子との接続用リードを一方側の前記リードフレームに形成し、前記接続用リードを前記一方側に立ち上げて接続端子を形成するとともに、実装基板への実装端子を有する実装用リードを他方側の前記リードフレームに形成し、

発振回路を形成した IC を、前記積層リードフレームに実装し、

パッケージの内部に圧電振動片を封止した前記圧電振動子を、前記積層リードフレームに実装し、

前記実装端子の主面を外部に露出させつつ、前記積層リードフレームおよび前記圧電振動子が樹脂パッケージの内部に封止してあるとともに、前記実装用リードを形成した他方側の前記リードフレームの厚みが、前記実装用リードに形成した前記実装端子より薄く形成してあることを特徴とする圧電発振器。

【請求項 3】 請求項 1 または 2 に記載の圧電発振器において、前記実装用リードは、基端側の厚みが先端側の前記実装端子より薄く形成してあることを特徴とする圧電発振器。

【請求項 4】 請求項 1 ないし 3 のいずれかに記載の圧電発振器において、

前記実装端子は、前記樹脂パッケージの下端面より高い位置に設けてあることを特徴とする圧電発振器。

【請求項 5】 2 枚のリードフレームで構成される積層リードフレームにつき、圧電振動子との接続用リードを一方側の前記リードフレームに形成し、実装基板への実装用リードを他方側の前記リードフレームに形成し、前記実装用リードを前記他方側に立ち上げて実装端子を形成し、

発振回路を形成した I C を、前記積層リードフレームに実装し、  
パッケージの内部に圧電振動片を封止した前記圧電振動子を、前記積層リードフレームに実装し、

前記実装端子の主面を外部に露出させつつ、前記積層リードフレームおよび前記圧電振動子が樹脂パッケージの内部に封止してあるとともに、前記接続用リードを形成した一方側の前記リードフレームの厚みが前記接続用リードに形成した接続端子より薄く形成してあることを特徴とする圧電発振器。

【請求項 6】 請求項 1 ないし 5 のいずれかに記載の圧電発振器において、  
前記接続用リードは、基端側の厚みが先端側の前記接続端子より薄く形成してあることを特徴とする圧電発振器。

【請求項 7】 請求項 1 ないし 6 のいずれかに記載の圧電発振器において、  
前記積層リードフレームに、前記 I C の特性検査、特性調整および／または前記圧電振動子と前記接続端子との導通確認をするための調整端子を形成し、

前記調整端子を外部に露出させつつ、前記積層リードフレームおよび前記圧電振動子を樹脂パッケージの内部に封止して形成したことを特徴とする圧電発振器。

【請求項 8】 請求項 7 に記載の圧電発振器において、  
前記実装端子は、前記調整端子と同じ高さに形成してあることを特徴とする圧電発振器。

【請求項 9】 請求項 1 ないし 8 のいずれかに記載の圧電発振器において、  
前記実装用リードは、基端側の厚みが先端側の前記実装端子より薄く形成してあることを特徴とする圧電発振器。

【請求項 1 0】 請求項 1 ないし 9 のいずれかに記載の圧電発振器において

前記接続用リードは、基端側の厚みが先端側の前記接続端子より薄く形成してあることを特徴とする圧電発振器。

【請求項 11】 請求項 1 ないし 10 のいずれかに記載の圧電発振器において、

前記積層リードフレームにおける前記一方側に前記 IC を実装したことを特徴とする圧電発振器。

【請求項 12】 請求項 1 ないし 11 のいずれかに記載の圧電発振器において、

前記圧電振動子のリッドの上面を外部に露出させつつ、前記積層リードフレームおよび前記圧電振動子を樹脂パッケージの内部に封止して形成したことを特徴とする圧電発振器。

【請求項 13】 請求項 1 ないし 11 のいずれかに記載の圧電発振器において、

前記圧電振動子のリッドを前記樹脂パッケージの内部に封止して形成したことを特徴とする圧電発振器。

【請求項 14】 請求項 1 ないし 13 のいずれかに記載の圧電発振器において、

前記実装端子の主面に加えて、前記実装端子の側面を外部に露出させつつ、前記積層リードフレームおよび前記圧電振動子を樹脂パッケージの内部に封止して形成したことを特徴とする圧電発振器。

【請求項 15】 請求項 1 ないし 14 のいずれかに記載の圧電発振器において、

前記実装端子は、前記主面に少なくとも 1 つ以上の凹部または凸部が形成されていることを特徴とする圧電発振器。

【請求項 16】 請求項 1 ないし 15 のいずれかに記載の圧電発振器において、

前記実装端子は、前記主面と反対側の樹脂との接合面に少なくとも 1 つ以上の凹部または凸部が形成されていることを特徴とする圧電発振器。

【請求項 17】 請求項 1 ないし 16 のいずれかに記載の圧電発振器において、

前記圧電振動子の高さ方向に対する係止部を前記パッケージの側面に形成した上で、

前記積層リードフレームおよび前記圧電振動子を樹脂パッケージの内部に封止して形成したことを特徴とする圧電発振器。

【請求項 18】 請求項 1 ないし 17 のいずれかに記載の圧電発振器において、

前記 IC の端子と前記実装端子とを接続するため、一对の配線用リードを前記一方側のリードフレームに形成し、前記各配線用リードを前記一方側に立ち上げて一对の配線端子を形成し、

前記 IC 端子または前記実装端子の一方に、前記一对の配線用リードの一方を接続するとともに、前記 IC 端子または前記実装端子の他方に、前記一对の配線用リードの他方を接続し、

前記一对の配線端子にそれぞれ接続される一对の電極パッドと、前記一对の電極パッドを相互に接続する配線パターンとを、前記圧電振動子に形成したことを特徴とする圧電発振器。

【請求項 19】 請求項 1 ないし 18 のいずれかに記載の圧電発振器において、

前記実装端子は、端部を前記樹脂パッケージの側面から突出させたことを特徴とする圧電発振器。

【請求項 20】 請求項 1 ないし 19 のいずれかに記載の圧電発振器において、

前記接続端子は、前記圧電振動子を接合する主面またはその反対側の面のいずれか一方または両方に、少なくとも 1 つ以上の凹部または凸部が形成されていることを特徴とする圧電発振器。

【請求項 21】 請求項 1 ないし 20 のいずれかに記載の圧電発振器において、

前記接続用リードまたは前記実装用リードのいずれか一方または両方に、樹脂

を入り込ませる切り欠きを形成したことを特徴とする圧電発振器。

【請求項 2 2】 請求項 1 ないし 2 1 のいずれかに記載の圧電発振器において、

前記他方側のリードフレームは、前記実装端子が他の部分より厚く形成してあることを特徴とする圧電発振器。

【請求項 2 3】 2 枚のリードフレームで構成される積層リードフレームにつき、圧電振動子との接続用リードを一方側の前記リードフレームに形成し、前記接続用リードを前記一方側に立ち上げて接続端子を形成するとともに、実装基板への実装用リードを他方側の前記リードフレームに形成し、前記実装用リードを前記他方側に立ち上げて実装端子を形成し、前記各リードフレームを積層して前記積層リードフレームを形成する工程と、

発振回路を形成した I C を、前記積層リードフレームに実装する工程と、

パッケージの内部に圧電振動片を封止した前記圧電振動子を、前記積層リードフレームに実装する工程と、

前記実装端子の主面を外部に露出させつつ、前記積層リードフレームおよび前記圧電振動子を樹脂パッケージの内部に封止する工程と、

を有することを特徴とする圧電発振器の製造方法。

【請求項 2 4】 2 枚のリードフレームで構成される積層リードフレームにつき、圧電振動子との接続用リードを一方側の前記リードフレームに形成し、前記接続用リードを前記一方側に立ち上げて接続端子を形成するとともに、実装基板への実装用リードを他方側の前記リードフレームに形成し、前記実装用リードの基端側を薄肉化して先端側に実装端子を形成し、前記各リードフレームを積層して前記積層リードフレームを形成する工程と、

発振回路を形成した I C を、前記積層リードフレームに実装する工程と、

パッケージの内部に圧電振動片を封止した前記圧電振動子を、前記積層リードフレームに実装する工程と、

前記実装端子の主面を外部に露出させつつ、前記積層リードフレームおよび前記圧電振動子を樹脂パッケージの内部に封止する工程と、

を有することを特徴とする圧電発振器の製造方法。



【請求項 2 5】 請求項 2 3 または 2 4 に記載の圧電発振器の製造方法において、

前記実装端子の主面に付着した樹脂を除去する工程を有することを特徴とする圧電発振器の製造方法。

【請求項 2 6】 請求項 2 3 ないし 2 5 のいずれかに記載の圧電発振器の製造方法において、

前記樹脂パッケージの内部に封止する工程は、前記実装端子の主面を金型面に押圧して行ない、

その後の前記樹脂パッケージを前記リードフレームの枠部から切り離す工程において、前記実装端子の不要部を切断する、

ことを特徴とする圧電発振器の製造方法。

#### 【発明の詳細な説明】

##### 【0 0 0 1】

##### 【発明の属する技術分野】

本発明は、圧電発振器およびその製造方法に関するものである。

##### 【0 0 0 2】

##### 【従来の技術】

電気回路において一定の周波数信号を得るため、圧電発振器が広く利用されている。特許文献 1 には、図 9 に示す従来の圧電発振器 5 0 1 が記載されている。なお、図 9 ( 1 ) は製造途中における平面図であり、図 9 ( 2 ) は図 9 ( 1 ) の H - H 線に相当する部分における側面断面図である。図 9 ( 2 ) に示す圧電発振器 5 0 1 では、リードフレーム 5 3 0 の下面に圧電振動子 5 1 0 が実装され、リードフレーム 5 3 0 の上面に集積回路素子 ( I C ) 5 6 0 が実装され、全体を樹脂封止するように樹脂パッケージ 5 7 0 が形成されている。なお、図 9 に示すシリンダ型の圧電振動子 5 1 0 は、圧電平板に励振電極を形成した圧電振動片を、金属製のシリンダ内部に封止して、前記励振電極と導通する外部リード 5 2 4 をシリンダ外部に引き出したものである。一方、 I C 5 6 0 は発振回路を形成したものである。

##### 【0 0 0 3】

図9(1)は、樹脂パッケージ570を形成する直前の状態を示している。リードフレーム530の中央にはダイパッド552が配置され、その上にIC560が実装されている。また、ダイパッド552の四方には圧電発振器501の実装用リード542が配置され、それぞれがIC560とワイヤボンディングにより電氣的に接続されている。なお、実装用リード542の OUTER 部分は、樹脂パッケージ570の形成後に下方に折り曲げられて、実装端子が形成される。さらに、図9(1)の上下方向における実装用リード542の中間部には、圧電振動子510とIC560との接続用リード532が形成されている。そして、接続用リード532の下面には圧電振動子510の外部リード524が接続され、接続用リード532の上面はIC560とワイヤボンディングにより接続されている。これにより、圧電振動子510とIC560とが電氣的に接続される。

なお特許文献2にも同様の構成が示されている。

#### 【0004】

【特許文献1】 実公平5-16724号公報

【特許文献2】 特許第2621828号公報

#### 【0005】

##### 【発明が解決しようとする課題】

圧電発振器は携帯電話等の通信手段に使用されるが、携帯電話等に対する小型化の要請は強くなっている。これに伴って、圧電発振器にも小型化、薄型化が強く要求されている。なお近時では、圧電振動片をパッケージ内部に封止するとともに、圧電振動片の励振電極と導通する外部電極をパッケージの裏面上に形成した、パッケージ型（平面実装型）の圧電振動子が開発されている。図9に示すシリンドラ型の圧電振動子510に代わって、パッケージ型の圧電振動子が開発されたのも、圧電発振器の小型化、薄型化の要求に応えるためである。

#### 【0006】

ところで、圧電発振器は、小型化されるのに伴って、実装基板に接合する実装端子なども小型化される。したがって、圧電発振器は、小型化されればされるほど、実装端子の実装基板への接合面積が小さくなって接合強度が低下する。このため、圧電発振器は、携帯電話等の携帯用電子機器に搭載された場合、これらが

取り落とされると、大きな衝撃力が作用して実装基板との接合部において剥離する可能性が増大する。このことは、樹脂パッケージを構成している樹脂とリードフレームの端子との接合部においても同様である。そこで、圧電発振器は、小型化されればされるほど、実装基板や、樹脂パッケージを構成する樹脂との接合強度を向上させることが大きな課題となる。

#### 【0007】

ところが、上述した圧電発振器では、接続用リードを実装用リードの中間部に配置する必要があるため、平面サイズが大きくなるという問題がある。そのため、圧電発振器の小型化には限界がある。

そこで本発明は、平面サイズを小さくすることにより小型化が可能な、圧電発振器およびその製造方法の提供を目的とする。

また、本発明は、接合強度を向上させることを目的としている。

#### 【0008】

##### 【課題を解決するための手段】

上記目的を達成するため、本発明に係る圧電発振器は、2枚のリードフレームで構成される積層リードフレームにつき、圧電振動子との接続用リードを一方側の前記リードフレームに形成し、前記接続用リードを前記一方側に立ち上げて接続端子を形成するとともに、実装基板への実装用リードを他方側の前記リードフレームに形成し、前記実装用リードを前記他方側に立ち上げて実装端子を形成し、発振回路を形成したICを、前記積層リードフレームに実装し、パッケージの内部に圧電振動片を封止した前記圧電振動子を、前記積層リードフレームに実装し、前記実装端子の主面を外部に露出させつつ、前記積層リードフレームおよび前記圧電振動子を樹脂パッケージの内部に封止して形成した。

#### 【0009】

この場合、接続端子および実装端子を重ねて配置することが可能となり、両者を並べて配置する必要がない。したがって、圧電発振器の平面サイズを小さくすることができる。なお、圧電振動子を積層リードフレームに実装する前に、圧電振動子の周波数調整およびICの動作チェックを行なうことにより、良品の圧電振動子および良品のICを組み合わせて圧電発振器を形成することができる。こ

れにより、良品の IC を廃棄することがなくなって IC の歩留まりが向上し、製造コストを削減することができる。

#### 【0010】

さらに、積層リードフレームおよび圧電振動子の全体を樹脂封止する構成としたので、圧電振動子および IC の種類の組み合わせが変わっても、同じ樹脂成型モールドを使用することが可能である。したがって、多品種少量生産に対応することができる。また、積層リードフレームおよび圧電振動子の全体を絶縁することが可能となり、またゴミや水分の浸入を防止することが可能となる。したがって、電気的および化学的な故障の発生を防止することができる。

#### 【0011】

また、本発明に係る圧電発振器は、2枚のリードフレームで構成される積層リードフレームにつき、圧電振動子との接続用リードを一方側の前記リードフレームに形成し、前記接続用リードを前記一方側に立ち上げて接続端子を形成するとともに、実装基板への実装端子を有する実装用リードを他方側の前記リードフレームに形成し、発振回路を形成した IC を、前記積層リードフレームに実装し、パッケージの内部に圧電振動片を封止した前記圧電振動子を、前記積層リードフレームに実装し、前記実装端子の主面を外部に露出させつつ、前記積層リードフレームおよび前記圧電振動子が樹脂パッケージの内部に封止してあるとともに、前記実装用リードを形成した他方側の前記リードフレームの厚みが、前記実装用リードに形成した前記実装端子より薄く形成した。

#### 【0012】

このようになっている本発明は、上記と同様の作用効果が得られるとともに、他方側のリードフレームが実装用リードに形成した実装端子より薄く形成したことにより、樹脂パッケージの薄型化を図ることができる。

#### 【0013】

実装用リードは、基端側の厚みを先端側の実装端子より薄く形成することができる。これにより、実装端子は、実装用リードを立ち上げる（折曲する）ことなしに形成することができる。このため、実装端子の面積を大きくすることが可能で、実装基板への実装強度（接合強度）を向上させることができる。そして、前

記実装端子は、前記樹脂パッケージの下端面より高い位置に設けることができる。これにより、圧電発振器を実装基板に実装したときに、実装端子と実装基板との間に形成される間隙をはんだが埋めるため、実装端子の接合状態を目視により容易に確認することができる。

#### 【0014】

さらに、本発明に係る圧電発振器は、2枚のリードフレームで構成される積層リードフレームにつき、圧電振動子との接続用リードを一方側の前記リードフレームに形成し、実装基板への実装用リードを他方側の前記リードフレームに形成し、前記実装用リードを前記他方側に立ち上げて実装端子を形成し、発振回路を形成したICを、前記積層リードフレームに実装し、パッケージの内部に圧電振動子を封止した前記圧電振動子を、前記積層リードフレームに実装し、前記実装端子の主面を外部に露出させつつ、前記積層リードフレームおよび前記圧電振動子が樹脂パッケージの内部に封止してあるとともに、前記接続用リードを形成した一方側の前記リードフレームの厚みが前記接続用リードに形成した接続端子より薄く形成してあることを特徴としている。これにより、樹脂パッケージの薄型化を図ることができる。

#### 【0015】

そして、前記接続用リードは、基端側の厚みが先端側の前記接続端子より薄く形成することができる。これにより、接続端子は、接続用リードを立ち上げなくても形成することができ、面積が大きくなって接合強度を向上することができる。また、前記積層リードフレームに前記ICの特性検査、特性調整および／または圧電振動子と接続端子との導通確認をするための調整端子を形成し、前記調整端子を外部に露出させつつ、前記積層リードフレームおよび前記圧電振動子を樹脂パッケージの内部に封止して形成してもよい。これにより、樹脂封止後の製品状態において、ICの特性検査、特性調整および／または圧電振動子と接続端子との導通確認を行なうことができる。

#### 【0016】

前記実装端子は、前記調整端子よりも高い位置であっても低い位置であってもよいが、前記調整端子と同じ高さに形成するとよい。これにより、他方側のリー

ドフレームを加工する際に、実装端子と調整端子とを異なる高さにするために、実装用リードを他方側に立ち上げる必要がなく、工程の簡素化を図ることができる。

#### 【0017】

前記実装用リードは、基端側の厚みを先端側の実装端子より薄く形成することができる。これにより、実装端子を形成する場合に、実装用リードを他方側に立ち上げる必要がなく、実装用リードに傾斜部が形成されないために実装端子の実質的な接合面積を大きくでき、実装基板に対する接合強度を向上することができる。さらに、前記接続用リードは、基端側の厚みを先端側の接続端子より薄く形成することができる。これにより、接続端子を形成する場合に、接続用リードを一方側に立ち上げる必要がなく、接続用リードに傾斜部が形成されないために接続端子の実質的な接合面積を大きくでき、圧電振動子との接合強度を向上することができる。

#### 【0018】

また、前記積層リードフレームにおける前記一方側に前記 IC を実装してもよい。これにより、仮に圧電発振器の下方から水分が侵入しても IC まで到達しにくくなるので、IC の故障を防止することができる。また、IC に温度補償回路を付加した場合には、その温度センサが圧電振動子の近くに配置されるので、温度センサと圧電振動片との温度差を小さくすることができる。したがって、圧電振動片の温度特性を正確に補正することができる。

#### 【0019】

また、前記圧電振動子のリッドの上面を外部に露出させつつ、前記積層リードフレームおよび前記圧電振動子を樹脂パッケージの内部に封止して形成してもよい。リッドの上面には圧電振動子の製品仕様が記載されているので、リッドを露出させることにより、樹脂パッケージの表面に製品仕様を記載する必要がなくなる。また、樹脂成型モールド金型内においてリッドの位置が固定されるため、圧電振動子の姿勢を安定させることができる。

#### 【0020】

また、前記圧電振動子のリッドを前記樹脂パッケージの内部に封止して形成し

てもよい。これにより、実装端子の表面にはんだメッキを施す工程において、露出したリッドがはんだメッキで被覆されるのを防止するため、リッドの上面をマスクする必要がなくなる。

#### 【0021】

また、前記実装端子の主面に加えて、前記実装端子の側面を外部に露出させつつ、前記積層リードフレームおよび前記圧電振動子を樹脂パッケージの内部に封止して形成してもよい。この場合、実装端子の主面からはみ出したはんだが、実装端子の側面に沿ってせり上がる。その結果、実装基板の電極から実装端子の側面にかけてフィレットが形成される。これにより、実装基板の電極と圧電発振器の実装端子との接続を、外観から簡単に確認することができる。

#### 【0022】

また、前記実装端子は、主面に少なくとも1つ以上の凹部または凸部を形成するとよい。主面に凹部または凸部を形成することにより、実装基板との実質的な接合面積が大きくなるとともに、凹部に入り込んだはんだ、または凸部がアンカー効果を発揮する。このため、実装端子と実装基板との接合強度を向上することができ、圧電発振器を実装基板に対して強固に固着することができる。さらに、実装端子は、主面と反対側の樹脂との接合面に少なくとも1つ以上の凹部または凸部を形成することができる。これにより、実装端子は、樹脂パッケージを構成している樹脂との接合面積が実質的に大きくなるとともに、凹部に入り込んだ樹脂、または凸部のアンカー効果により、樹脂との接合強度を向上することができ、樹脂との剥離を防ぐことができる。

#### 【0023】

また、前記圧電振動子の高さ方向に対する係止部を前記パッケージの側面に形成した上で、前記積層リードフレームおよび前記圧電振動子を樹脂パッケージの内部に封止して形成してもよい。これにより、圧電振動子が圧電発振器から抜けにくくなるため強固に固定されることとなる。

#### 【0024】

また、前記ICの端子と前記実装端子とを接続するため、一対の配線用リードを前記一方側のリードフレームに形成し、前記各配線用リードを前記一方側に立

ち上げて一对の配線端子を形成し、前記 IC 端子または前記実装端子の一方に、前記一对の配線用リードの一方を接続するとともに、前記 IC 端子または前記実装端子の他方に、前記一对の配線用リードの他方を接続し、前記一对の配線端子にそれぞれ接続される一对の電極パッドと、前記一对の電極パッドを相互に接続する配線パターンとを、前記圧電振動子に形成してもよい。これにより、実装端子の機能の割り当て順序に対して IC 端子の機能の割り当て順序が異なる場合であっても、対応する端子間を電氣的に接続することができる。その結果、実装端子の機能の割り当て順序が異なる圧電発振器の間においても、同種の IC を流用することが可能になる。したがって、IC の種類が削減され、製造コストおよび製品コストを削減することができる。

#### 【0025】

前記実装端子は、端部を前記樹脂パッケージの側面から突出させることができる。これにより、実装端子を実装基板に接合したときに、はんだが実装端子の樹脂パッケージから突出した部分にせり上がってフィレットを形成するため、目視によって実装（接合）の良否を容易に判断することができる。また、はんだが樹脂パッケージから突出している実装端子に覆うため、実装強度を向上することができる。

#### 【0026】

また、前記接続端子は、前記圧電振動子を接合する主面またはその反対側の面のいずれか一方または両方に、少なくとも 1 つ以上の凹部または凸部を形成することができる。これにより、接続端子は、圧電振動子との接合面積、または樹脂パッケージの樹脂との接合面積が増大するとともに、接続端子に設けた凹部または凸部によるアンカー効果が生じて、圧電振動子または樹脂パッケージの樹脂との接合強度を向上することができる。

#### 【0027】

さらに、前記接続用リードまたは前記実装用リードのいずれか一方または両方に、樹脂を入り込ませる切り欠きを設けることができる。これにより、樹脂パッケージを構成する樹脂が切り欠きに入り込んでアンカー効果を発揮するため、樹脂と接続用リードまたは実装用リードとの接合強度が向上し、耐衝撃性を高める



ことができる。

#### 【0028】

他方のリードフレームは、前記実装端子を他の部分より厚く形成することができる。これにより、実装端子を樹脂パッケージから露出させた場合、実装端子以外の他の不要な部分は実装端子より厚みが薄いため、他側のリードフレームを折曲しなくとも樹脂パッケージ内に封止される。したがって、実装基板に実装端子を接合したときに、実装端子以外の部分は、樹脂パッケージから露出しないため、実装基板に設けたパターンなどと短絡するおそれがない。

#### 【0029】

一方、本発明に係る圧電発振器の製造方法は、2枚のリードフレームで構成される積層リードフレームにつき、圧電振動子との接続用リードを一方側の前記リードフレームに形成し、前記接続用リードを前記一方側に立ち上げて接続端子を形成するとともに、実装基板への実装用リードを他方側の前記リードフレームに形成し、前記実装用リードを前記他方側に立ち上げて実装端子を形成し、前記各リードフレームを積層して前記積層リードフレームを形成する工程と、発振回路を形成したICを、前記積層リードフレームに実装する工程と、パッケージの内部に圧電振動片を封止した前記圧電振動子を、前記積層リードフレームに実装する工程と、前記実装端子の主面を外部に露出させつつ、前記積層リードフレームおよび前記圧電振動子を樹脂パッケージの内部に封止する工程と、を有する構成とした。これにより、圧電発振器の平面サイズを小さくすることができる。

#### 【0030】

さらに、本発明に係る圧電発振器の製造方法は、2枚のリードフレームで構成される積層リードフレームにつき、圧電振動子との接続用リードを一方側の前記リードフレームに形成し、前記接続用リードを前記一方側に立ち上げて接続端子を形成するとともに、実装基板への実装用リードを他方側の前記リードフレームに形成し、前記実装用リードの基端側を薄肉化して先端側に実装端子を形成し、前記各リードフレームを積層して前記積層リードフレームを形成する工程と、発振回路を形成したICを、前記積層リードフレームに実装する工程と、パッケージの内部に圧電振動片を封止した前記圧電振動子を、前記積層リードフレームに

実装する工程と、前記実装端子の主面を外部に露出させつつ、前記積層リードフレームおよび前記圧電振動子を樹脂パッケージの内部に封止する工程と、を有することを特徴としている。これにより、実装用リードは、傾斜部が形成されないため、実装端子の実質的な接合面積を大きくすることができ、実装基板に対する接合強度を大きくすることができる。実装用リードの基端側の薄肉化は、プレスによる塑性加工やエッチングによって容易に行なうことができる。

#### 【0031】

また、前記実装端子の主面に付着した樹脂を除去する工程を有する構成としてもよい。これにより、実装端子の主面にはんだメッキを施すことができる。さらに、前記樹脂パッケージの内部に封止する工程は、前記実装端子の主面を金型面に押圧して行ない、その後の前記樹脂パッケージを前記リードフレームの枠部から切り離す工程において、前記実装端子の不要部を切断することができる。これにより、樹脂封止の際に実装端子の主面が金型面に密着させられるため、実装端子の主面に樹脂が付着するのを防止でき、主面に付着した樹脂を除去する工程を省くことができる。そして、樹脂パッケージをリードフレームの枠部から切り離すときに、実装端子の不要部を切断して除去すれば、実装面積が大きくなるのを防ぐことができる。

#### 【0032】

##### 【発明の実施の形態】

本発明に係る圧電発振器およびその製造方法の好ましい実施の形態を、添付図面に従って詳細に説明する。なお以下に記載するのは本発明の実施形態の一態様にすぎず、本発明はこれらに限定されるものではない。

#### 【0033】

最初に、第1実施形態について説明する。

図1に、第1実施形態に係る圧電発振器を分解した状態の斜視図を示す。また図2に、図1のA-A線における側面断面図を示す。なお、図2では樹脂パッケージ70を取り除いた状態を示している。すなわち、図2における積層リードフレーム50の部分の断面は、実際には切断されていない位置の端子部分を付しているが、これは理解の便宜のために付したもので、切断面を示すものではなく、

各端子部分等の上下方向（垂直方向）の位置を示すものである。第1実施形態に係る圧電発振器1は、2枚のリードフレーム30、40で構成される積層リードフレーム50につき、圧電振動子10との接続用リード32を上側リードフレーム30に形成し、その接続用リード32を上側に立ち上げて接続端子36を形成するとともに、実装基板への実装用リード42を下側リードフレーム40に形成し、その実装用リード42を下側に立ち上げて実装端子46を形成し、発振回路を形成したIC60を積層リードフレーム50に実装し、パッケージ20の内部に圧電振動片12を封止した圧電振動子10を積層リードフレーム50に実装し、前記実装端子46の主面を露出させつつ、積層リードフレーム50および圧電振動子10を樹脂パッケージ70（図2参照）の内部に封止して形成したものである。なおICは、抵抗やコンデンサ等の電子部品であってもよい。

#### 【0034】

図3にリードフレームの平面図を示す。なお、図3（1）は上側リードフレームの平面図であり、図3（2）は下側リードフレームの平面図である。第1実施形態では、2枚のリードフレーム30、40を重ね合わせて積層リードフレーム50を形成する。各リードフレーム30、40は、導電性を有する金属シートに井桁状の枠部31、41を設けるとともに、各枠部31、41の内側に同一のパターンを繰り返し形成したものである。

#### 【0035】

図3（1）に示す上側リードフレーム30では、枠部31の内側の四隅に、圧電振動子との接続用リード32を形成する。なお圧電振動子には、一对の励振電極と導通する外部電極およびGND用の外部電極を合わせて、少なくとも3個の外部電極が形成されるので、上側リードフレーム30には少なくとも3個の接続用リード32を形成する。そして、枠部31の長辺方向における各接続用リード32の内側端部には、ワイヤボンディング用のパッド34を形成する。なお、パッド34を枠部31と同一平面上に支持すべく、パッド34を枠部31の長辺に接続する。これにより、接続用リード32が枠部31に固定される。一方、パッド34の外側に傾斜部35を形成し、さらに傾斜部35の外側に接続端子36を形成する。そして図1に示すように、パッド34から傾斜部35を上側に立ち上

げることにより、上側リードフレーム 3 0 から所定距離をおいて平行に接続端子 3 6 を配置する。なお所定距離とは、I C 6 0 にボンディングされたワイヤ 6 2 の最大高さより大きい距離とする。

#### 【 0 0 3 6 】

図 3 ( 2 ) に示す下側リードフレーム 4 0 では、枠部 4 1 の内側の四隅に、実装基板への実装用リード 4 2 を形成する。なお、枠部 4 1 の短辺方向における各実装用リード 4 2 の内側端部には、ワイヤボンディング用のパッド 4 4 を形成する。なお、パッド 4 4 を枠部 4 1 と同一平面上に支持すべく、パッド 4 4 を枠部 4 1 の短辺に接続する。これにより、実装用リード 4 2 が枠部 4 1 に固定される。一方、パッド 4 4 の外側に傾斜部 4 5 を形成し、さらに傾斜部 4 5 の外側に実装端子 4 6 を形成する。そして図 1 に示すように、パッド 4 4 から傾斜部 4 5 を下側に立ち上げるることにより、下側リードフレーム 4 0 から所定距離をおいて平行に実装端子 4 6 を配置する。

#### 【 0 0 3 7 】

また、枠部 4 1 の短辺方向における各実装用リード 4 2 の中間部には、I C の特性検査、特性調整および／または圧電振動子と接続端子との導通確認をするための調整端子 5 4 を形成する。なお、特性検査とは、樹脂成形後における I C の動作チェックや、圧電発振器としての特性検査などをいう。また、特性調整とは、I C に温度補償回路が付加された場合に、圧電発振器の温度による周波数変化を補正したり、入力電圧によって周波数を変化させる機能が I C に付加された場合に、その変化感度を調整したりすることなどをいう。調整端子 5 4 は、枠部 4 1 の短辺に接続して、下側リードフレーム 4 0 と同一平面上に支持する。なお、下側リードフレーム 4 0 から下側に所定距離をおいて実装端子 4 6 を配置するので、調整端子 5 4 が実装基板の電極等と短絡することはない。一方、下側リードフレーム 4 0 における枠部 4 1 内の中央部には、ダイパッド 5 2 を形成する。ダイパッド 5 2 は、枠部 4 1 の長辺に接続して、下側リードフレーム 4 0 と同一平面上に支持する。なお、調整端子 5 4 およびダイパッド 5 2 は、上側リードフレームに形成してもよい。また、接続端子、実装端子、調整端子およびダイパッドが各枠部に接続される位置は、長辺または短辺に限定されるものではない。例え

ば、調整端子数が多い場合には、調整端子は長辺側に接続され、ダイパッドは短辺側に接続される。

#### 【0038】

そして、上側リードフレーム30と下側リードフレーム40とを重ね合わせ、積層リードフレームを形成する。上側リードフレーム30および下側リードフレーム40は、それぞれの枠部31、41にスポット溶接等を施すことによって固着する。なお、枠部31、41の内側では、上側リードフレーム30および下側リードフレーム40が接触しないように、各リードフレームの各リードを形成する。

#### 【0039】

一方、図1に示すように、ダイパッド52の上面に集積回路素子(IC)60を実装する。IC60には発振回路を形成し、必要に応じて温度補償回路や電圧制御回路を付加する。そして、接着剤を介してIC60をダイパッド52の上面に装着する。なお、IC60はダイパッド52の下面に装着してもよい。もっとも、ダイパッド52の上面にIC60を装着すれば、仮に圧電発振器の下方から水分が侵入してもIC60まで到達しにくくなるので、IC60の故障を防止することができる。また、IC60に温度補償回路を付加した場合には、その温度センサが圧電振動子10の近くに配置されるので、温度センサと圧電振動片12との温度差を小さくすることができる。したがって、圧電振動片12の温度特性を正確に補正することができる。

#### 【0040】

さらに、積層リードフレーム50の各端子とIC60上面の各端子とを電氣的に接続する。具体的には、接続端子36のパッド34、実装端子46のパッド44および調整端子54と、IC60上面の各端子とを、ワイヤボンディングにより接続する。なお、接続用リード32に切り欠き38を形成したので、実装端子46のパッド44が上方に露出する。これにより、実装端子46のパッド44に対してワイヤボンディングを行なうことができる。

#### 【0041】

一方で、圧電振動片12をパッケージ20の内部に封入した圧電振動子10を

形成する。図2に示すように、パッケージ20は、セラミック材料等からなる複数のシートを積層・焼成して形成する。具体的には、各シートを所定の形状にブランクし、各シートの表面に所定の配線パターンを形成した上で、各シートを積層・焼成する。このパッケージ20にはキャビティ21を形成し、キャビティ21の底面にはマウント電極22を形成する。また、パッケージ20の裏面には外部電極24を形成し、配線パターン23および24aを介してマウント電極22との導通を確保する。なお、側面電極24aではなくスルーホールを介して上下接続してもよい。

#### 【0042】

圧電振動片12は、図1に示すように、水晶等の圧電材料からなる平板の両面に、励振電極14を形成したものである。なお、圧電平板の端部には、各励振電極14と導通する接続電極15を形成する。そして、図2に示すように、パッケージ20におけるキャビティ21の内部に、圧電振動片12を片持ち状態で実装する。具体的には、パッケージ20のマウント電極22に導電性接着剤13を塗布し、圧電振動片12の接続電極15（図1参照）を接着する。これにより、パッケージ20の外部電極24から圧電振動片12の励振電極14（図1参照）に対して通電可能となる。なお、圧電振動片12は両持ち実装であっても構わない。

#### 【0043】

さらに、パッケージ20におけるキャビティ21の開口部にリッド28を装着して、キャビティ21の内部を窒素雰囲気や真空雰囲気に気密封止する。なお、金属製リッドの場合はシーム溶接により、ガラス製リッドの場合は低融点ガラスを介して、パッケージ20に装着する。以上により圧電振動子10が完成する。なお、パッケージ20の内部に実装するのは、ATカット圧電振動片に限られず、音叉型圧電振動片やSAWチップであってもよい。

#### 【0044】

なお、圧電振動子10を積層リードフレーム50に実装する前に、圧電振動子10の周波数調整およびIC60の動作チェックを行なう。これにより、良品の圧電振動子10および良品のIC60を組み合わせて圧電発振器を形成すること

ができる。なお、パッケージの内部にまず IC を実装し、その上方に圧電振動片を実装するタイプの圧電発振器では、圧電振動片を実装した後の周波数調整段階で圧電振動片の不良が発見されることがある。この場合、不良品の圧電振動片とともに良品の IC も廃棄することになる。この点、第 1 実施形態では、良品の IC を廃棄することがなくなるので、IC の歩留まりが向上し、製造コストを削減することができる。

#### 【0045】

そして、圧電振動子 10 を積層リードフレーム 50 に実装する。具体的には、はんだ 25 や導電性接着剤等を介して、圧電振動子 10 の外部電極 24 を積層リードフレームの接続端子に接続する。なお、圧電振動子 10 の外部電極 24 はパッケージ 20 の裏面のみに形成してもよいが、裏面から側面にかけて外部電極 24a を延長形成するのが好ましい。この場合、パッケージ 20 の裏面からはみ出したはんだが、側面の外部電極 24a に沿ってせり上がる。その結果、積層リードフレーム 50 の接続端子 36 からパッケージ側面の外部電極 24a にかけてフィレット 25a が形成される。これにより、積層リードフレーム 50 の接続端子 36 と圧電振動子 10 の外部電極 24 との接続を、外観から簡単に確認することができる。なお、圧電振動子 10 の外部電極 24 は、パッケージ 20 の側面のみに形成してもよい。また、本実施形態では圧電振動子を接続端子のみで支持しているが、電氣的に独立したダミーの接続端子等を加えて圧電振動子を支持すれば、支持力の向上およびリードフレームの変形防止が可能となる。

#### 【0046】

そして、積層リードフレーム 50 および圧電振動子 10 を樹脂パッケージ 70 の内部に封止する。具体的には、圧電振動子 10 を実装した積層リードフレーム 50 を樹脂成型モールド内に配置して、熱硬化性樹脂を射出成型することにより樹脂パッケージ 70 を形成する。樹脂パッケージ 70 は、図 3 に示すように、各リードフレーム 30、40 の枠部 31、41 の内側に形成する。樹脂パッケージ 70 の成型後には、各リードフレーム 30、40 の枠部 31、41 と各リードとの接続部を切断する。その切断位置 39、49 は、樹脂パッケージ 70 の表面付近とするのが好ましい。なお、IC の調整端子 54 は、樹脂パッケージ 70 から

突出させて切断する。

#### 【0047】

図2に示すように、積層リードフレーム50および圧電振動子10を樹脂パッケージ70の内部に封止することにより、両者の相対位置を固定することができる。なお、圧電振動子10のパッケージ20の側面に凹凸を形成して樹脂封止すれば、その凹凸に係止部となって、圧電振動子が圧電発振器から抜けにくくなるため強固に固定されることとなる。図4に、圧電振動子のパッケージの側面角部に形成されたキャストレーションを示す。パッケージ20の側面には、一般にキャストレーション18が形成される。そこで、キャストレーション18に係止部19を形成する。係止部19を形成するには、パッケージ20を構成するセラミックシートの一部20bにつき、図4(1)ないし図4(8)のように、キャストレーションとなる貫通孔の直径を変更したり、貫通孔の穿設位置を変更したりすればよい。なお、図4(1)ないし図4(3)はパッケージの角部におけるキャストレーションに係止部を形成した例であり、図4(4)ないし図4(8)はパッケージの側面におけるキャストレーションに係止部を形成した例である。

#### 【0048】

一方、樹脂パッケージ70の上面には、圧電振動子10のリッド28の上面を露出させる。リッド28の上面には圧電振動子10の製品仕様が記載されているので、リッド28を露出させることにより、樹脂パッケージ70の表面に製品仕様を記載する必要がなくなる。また、樹脂成型モールド内における圧電振動子10の姿勢を安定させることができる。一方、後述するように、実装端子46の表面にはんだメッキを施す工程では、露出したリッド28がはんだメッキで被覆されるのを防止するため、リッド28の上面をマスクする必要がある。この点、樹脂パッケージ70の内部にリッド28を封止した場合には、かかる必要がない。

#### 【0049】

また、樹脂パッケージ70の下面には、実装端子46の主面を露出させる。図5(1)に図2のD矢視図を示し、図5(2)に図5(1)のF-F線における底面断面図を示す。図5(1)に示すように、本実施形態に係る圧電発振器1は、実装基板の電極8に対して、はんだ9を介して実装する。そこで、実装端子4



6は、その主面に加えて側面46aも露出させるのが好ましい。この場合、実装端子46の主面からはみ出したはんだ9が、側面46aに沿ってせり上がる。その結果、実装基板の電極8から実装端子の側面46aにかけてフィレット9aが形成される。これにより、実装基板の電極8と圧電発振器1の実装端子46との接続を、外観から簡単に確認することができる。

#### 【0050】

また、図5(2)に示すように、実装端子46の主面にあらかじめディンプル(凹部)47を形成しておいてもよい。ディンプル47は、実装端子46の主面におけるディンプル47の形成部分以外の部分をマスクして、実装端子46の主面をハーフエッチングすることにより形成する。このような実装端子46を有する圧電発振器1を実装すると、ディンプル47にはんだが入り込んでアンカー効果を発揮する。したがって、圧電発振器1の実装端子46を実装基板の電極8に対して強固に固着することができ、圧電発振器1の実装強度を向上することができる。

#### 【0051】

なお、図5(1)に示すように、樹脂パッケージ70の下面に実装端子46の主面を露出させるには、樹脂成型モールドの底面に実装端子46の主面を面接触させた状態で樹脂を射出成型する。ところが、樹脂の射出圧力により、実装端子46の主面と樹脂成型モールドとの間に樹脂が入り込んで、実装端子46の主面に樹脂が付着してしまう。次述するように、実装端子46の主面にはんだメッキを施すが、実装端子46の主面に樹脂が付着しているとはんだメッキが付着しなくなる。そこで、実装端子46の主面に付着した樹脂を除去する作業を行なう。樹脂の除去は、研磨剤入りの液体や水などを実装端子46に向かって吹き付ける方法によって行なう。なお、実装端子46に向かってレーザを照射する方法や、薬品を塗布する方法などによって樹脂を除去してもよい。

#### 【0052】

次に、実装端子46の下面にはんだメッキを施す。その際、露出したリッド28(図2参照)の上面がはんだメッキで被覆されないように、リッド28の上面をマスクして行なう。

次に、圧電発振器の周波数調整を行なう。図6に、周波数調整工程の説明図を示す。なお図6は、図1のA-A線に相当する部分における側面断面図である。図6(1)に示すように、樹脂パッケージ70の外部に露出している調整端子54に下側からプローブ80を接触させ、IC60への書き込みを行なうことによって圧電発振器1の周波数調整を行なう。なお、プローブ80は、上側から接触させてもよい。なお、周波数調整後の調整端子54は、樹脂パッケージ70の表面付近で切り落とす。また、プローブ80により調整端子54を折り曲げつつ圧電発振器1の周波数調整を行ない、周波数調整後に調整端子54を切り落とすことなくそのまま製品化してもよい。図6(2)は、樹脂パッケージの変形例である。この変形例では、調整端子55の上方に樹脂パッケージ72を拡張成型している。この圧電発振器1の周波数調整も上記と同様に行なうが、周波数調整後に調整端子55を切り落とすことなく、そのまま製品化する。

以上により、第1実施形態に係る圧電発振器が完成する。

以上に詳述した第1実施形態にかかる圧電発振器により、平面サイズを小さくすることができる。

#### 【0053】

すなわち、第1実施形態では、2枚のリードフレームで構成される積層リードフレームにつき、圧電振動子との接続用リードを上側リードフレームに形成し、その接続用リードを上側に立ち上げて接続端子を形成するとともに、実装基板への実装用リードを下側リードフレームに形成し、その実装用リードを下側に立ち上げて実装端子を形成する構成とした。この場合、接続端子および実装端子を上下に重ねて配置することが可能となり、両者を並べて配置する必要がない。したがって、圧電発振器の平面サイズを小さくすることができる。また、実装端子の面積を広く確保することができる。

#### 【0054】

なお、第1実施形態では、圧電振動子および積層リードフレームの全体を樹脂パッケージの内部に封止する構成とした。この場合、圧電振動子およびICの種類の組み合わせが変わっても、同じ樹脂成型モールドを使用することが可能であり、多品種少量生産に対応することができる。また、樹脂パッケージの外形に対

して接続端子の位置を正確に決めることができるので、圧電発振器を外形基準で位置決めすることにより、実装基板上に正確に実装することができる。さらに、樹脂封止することによって、圧電振動子および積層リードフレームの全体を絶縁することが可能となり、またゴミや水分の浸入を防止することが可能となる。したがって、電気的および化学的な故障の発生を防止することができる。

#### 【0055】

次に、第2実施形態について説明する。

図8に、配線状態の説明図を示す。第2実施形態に係る圧電発振器は、IC160の端子bと実装端子Bとを接続するため、一对の配線用リード132r、132uを上側リードフレーム130に形成し、各配線用リード132r、132uを上側に立ち上げて一对の配線端子156r、156uを形成し、IC端子bに配線用リード132rを接続するとともに、実装端子Bに配線用リード132uを接続し、一对の配線端子156r、156uにそれぞれ接続される一对の電極パッド127r、127uと、一对の電極パッド127r、127uを相互に接続する配線パターン126xとを、圧電振動子に形成したものである。なお、第1実施形態と同様の構成となる部分については、その説明を省略する。

#### 【0056】

第2実施形態では、IC160の上面の各端子が順にa、b、c、dの機能を有するのに対して、実装端子には順にA、D、C、Bの機能を割り当てる場合を考える。なお、汎用のICを流用しながら、実装基板の電極に合わせて実装端子の機能を割り当てると、かかる場合が発生しうるのである。ここで、b-B間およびd-D間をワイヤボンディングにより接続すると、ワイヤが交差して短絡するおそれがある。したがって、これらの端子間をワイヤボンディングで配線することはできない。そこで第2実施形態では、IC端子から実装端子への配線パターン126を、圧電振動子のパッケージに形成する。

#### 【0057】

図7に、第2実施形態に係る圧電発振器を分解した状態の斜視図を示す。第2実施形態でも、2枚のリードフレーム130、140を重ね合わせて積層リードフレーム150を形成する。上側リードフレーム130の四方には接続用リード

132を形成し、その外側部分を上側に立ち上げて接続端子136を形成する。そして、図7の奥行方向における各接続用リード132の中間部には、配線用リード152を形成する。さらに、配線用リード152の外側部分を上側に立ち上げて、配線端子156を形成する。なお第2実施形態では、各接続端子136の中間部に、2個の配線端子156を並べて形成する。一方、下側リードフレーム140の四方には実装用リード142を形成し、その外側部分を下側に立ち上げて実装端子146を形成する。

#### 【0058】

一方、圧電振動子110におけるパッケージ120の裏面の四隅には、外部電極124を形成する。そして、図7の奥行方向における各外部電極124の中間部に、電極パッド127を形成する。なお第2実施形態では、各外部電極124の中間部に、2個の電極パッド127を並べて形成する。また、図7の左右方向に配置された電極パッド127を相互に接続する配線パターン126を形成する。なお第2実施形態では、2本の配線パターン126を並べて形成する。なお、配線パターンは必ずしもパッケージ裏面に形成する必要はなく、パッケージ120の側面や内部に形成してもよい。

#### 【0059】

そして、図8に示すように、IC160と各リードとを以下のようにして接続する。なお図8は、積層リードフレームの接続端子および圧電振動子の外部電極を省略して記載している。まず、IC端子aおよび実装端子A、ならびにIC端子cおよび実装端子Cを、ワイヤボンディングにより電氣的に接続する。また、IC端子bは配線用リード132rに、実装端子Bは配線用リード132uに、それぞれワイヤボンディングにより接続する。ここで、圧電振動子を積層リードフレームに実装し、電極パッド127rを配線端子156rに、電極パッド127uを配線端子156uに接続すれば、パッケージの裏面に形成した配線パターン126xを介して、IC端子bと実装端子Bとが電氣的に接続される。同様に、IC端子dは配線端子156tに、配線端子156sは実装端子Dに、それぞれ接続する。ここで、圧電振動子を積層リードフレームに実装し、電極パッド127tを配線端子156tに、電極パッド127sを配線端子156sに接続す

れば、パッケージの裏面に形成した配線パターン 126y を介して、IC 端子 d と実装端子 D とが電氣的に接続される。

#### 【0060】

以上に詳述した第2実施形態に係る圧電発振器では、実装端子の機能の割り当て順序に対して IC 端子の機能の割り当て順序が異なる場合であっても、対応する端子間を電氣的に接続することができる。その結果、実装端子の機能の割り当て順序が異なる圧電発振器の間においても、同種の IC を流用することが可能になる。したがって、IC の種類が削減され、製造コストおよび製品コストを削減することができる。

#### 【0061】

図10は、第3実施形態に係る下側リードフレームの平面図である。この下側リードフレーム40Aは、図3(1)に示した上側リードフレーム30とともに積層リードフレームを構成する。第3実施形態の下側リードフレーム40Aは、実装用リード42Aが図3(2)に示した第1実施形態の下側リードフレーム40の実装用リード42と異なっているが、その他は下側リードフレーム40と同じである。すなわち、下側リードフレーム40Aは、各実装用リード42Aの実装端子46Aが傾斜部45の図10の左右方向における長さより大きく形成してあって、傾斜部45より枠部41の短辺側に突出した押え代170を有する。この押え代170は、下側リードフレーム40Aが上側リードフレーム30とともに積層フレームにされ、実装された圧電振動子10とIC60とを樹脂封止するときに、金型の上型によって下方に押圧される。図11は、樹脂パッケージ70を形成する金型を模式的に示したものである。

#### 【0062】

図11(1)に示したように、上型172には、下側リードフレーム40Aに設けた4つの押え代170に対応して4つの押圧凸部174が設けてある。これらの押圧凸部174は、樹脂パッケージ70を形成する際に、実装用リード42Aの押え代170を上方から押圧し、実装端子46Aの主面(下面)を下型176の上面178に密着させる。このため、樹脂パッケージ70を形成する際に、樹脂が実装端子46Aの主面に付着するのを防止することができ、主面に付着し

た樹脂を除去する工程を省略することができる。なお、上型 1 7 2 と下型 1 7 6 とは、押圧凸部 1 7 4 が形成されていない部分においては、同図（2）に示したように、調整端子 5 4 の高さ位置で合わせるようになっている。

#### 【0 0 6 3】

下側リードフレーム 4 0 A の実装用リード 4 2 A は、上記のようにして樹脂パッケージ 7 0 を形成したのち、樹脂パッケージ 7 0 を積層リードフレーム（下側リードフレーム 4 0 A の枠部 4 1）から切り離す切断工程において、図 1 0 の 2 点鎖線に示した切断線 4 9 A によって切断され、押え代 1 7 0 が切り落とされる。ただし、押え代 1 7 0 は、図 1 0 に示してあるように、実装端子 4 6 A の先端部が樹脂パッケージ 7 0 の側面から少し（例えば 0. 1 ～ 0. 2 mm 程度）突出するように切断される。

#### 【0 0 6 4】

図 1 2 は、圧電発振器（樹脂パッケージ 7 0）を積層リードフレームから切り離すときの、押え代 1 7 0 の切断状態を模式的に示したものである。樹脂パッケージ 7 0 を形成された積層リードフレームは、例えば切断機の下刃 1 9 0 の上に配置され、上刃 1 9 2 が矢印 1 9 4 のように下降することによって押え代 1 7 0 が切断される。このとき、積層リードフレームは、実装端子 4 6 A が所定の長さ d だけ樹脂パッケージ 7 0 から突出して押え代 1 7 0 が切断されるように位置決めする。このようにして押え代 1 7 0 を切断することにより、積層リードフレームの位置ずれが生じて同図の 1 点鎖線 1 9 6 の位置で切断される場合であっても、実装端子 4 6 A の側面（端面）が樹脂パッケージ 7 0 から露出するため、はんだフィレットを目視でき、接合状態を容易に確認することができる。

#### 【0 0 6 5】

図 1 3 は、積層リードフレームから切り離された実装端子 4 6 A を備えた圧電発振器 1 8 0 を示したものであって、（1）は圧電振動子 1 0 と IC 6 0 との実装状態を模式的に示したものであり、（2）は上面図、（3）は底面図である。ただし、図 1 3 においては、調整端子 5 4 が左右に 4 本ずつ設けられた場合を示している。この圧電発振器 1 8 0 は、はんだメッキされた実装端子 4 6 A の先端部が樹脂パッケージ 7 0 の側面から突出している。したがって、圧電発振器 1 8

0は、図14に示したように、実装端子46Aを実装基板182の電極184にはんだ186によって接合したときに、実装端子46Aがはんだメッキしてあるため、はんだ186がせり上がって実装端子46Aの突出部を覆ってフィラーを形成する。このため、圧電発振器180は、実装基板182への接合（実装）状態を目視によって容易に確認することができる。また、はんだ186が実装端子46Aの突出部を覆うため、実装強度を向上することができる。なお、押え代170は、調整端子54を切断するときに切断してもよい。また、実装端子46Aは、樹脂パッケージ70の長辺に沿った部分を突出させるようにしてもよいし、L字状に突出させてもよい。

#### 【0066】

図15は、第4実施形態に係る下側リードフレームを示したものであって、（1）は平面図、（2）は（1）のC-C線に沿った断面図である。この下側リードフレーム40Bは、図3（1）に示した上側リードフレーム30とともに積層リードフレームを構成する。この第4実施形態の下側リードフレーム40Bは、図15（2）に示してあるように、実装用リード42Bが傾斜部を有しておらず、実装端子46Bとパッド44とが同一平面内に形成してあり、調整端子54と同じ高さに形成される。このため、下側リードフレーム40Bは、実装端子46Bを調整端子54より下側に位置させるための曲げ加工を必要とせず、下側リードフレーム40Bを形成する工程の簡素化が図れる。

#### 【0067】

第4実施形態の下側リードフレーム40Bを用いた積層リードフレームにおける樹脂封止は、図16のようにして行なわれる。すなわち、樹脂パッケージ70Bを形成する上型200と下型202とは、実装端子46Bの高さの位置で合わせるようになっている。そして、下型202には、キャビティを形成する面に凹部204が設けてあり、樹脂パッケージ70Bの下端面206が調整端子54、すなわち実装端子46Bの主面の下方に位置するようになっている。つまり、樹脂パッケージ70Bは、各実装端子46Bと対応した位置に凹部208が形成され、この凹部208の天井面に実装端子46Bが設けられた形状をなす。これは、切断したのちの調整端子54が実装基板に接触して実装基板に設けた配線パタ

ーンや他の部品と短絡したりするのを防止するためである。なお、凹部 208 の高さは、調整端子 54 が実装基板の表面に接触しない高さであればよく、例えば 0.1mm 程度であってよい。

#### 【0068】

図 17 は、実装端子 46B を有する圧電発振器 210 を示したものであって、(1) は圧電振動子 10 と IC60 との実装状態を示す模式図であり、(2) は平面図、(3) は底面図である。この圧電発振器 210 は、例えば図 18 に示したようにして実装基板 182 に実装することができる。この実装方法は、まず、図 18 (1) に示したように、圧電発振器 210 の各実装端子 46B にはんだボール 212 を設ける。そして、はんだボール 212 を実装基板 182 の電極 184 の上に配置する。その後、同図 (2) に示したように、はんだボール 212 を溶融することにより、圧電発振器 210 を実装基板 182 に実装することができる。

#### 【0069】

このようにして実装基板 182 に実装された圧電発振器 210 は、実装端子 46B が凹部 208 の天井面に設けてあるため、実装端子 46B と実装基板 182 との間に間隙  $g$  が形成される。そして、この間隙  $g$  は、はんだボール 212 を構成していたはんだ 220 によって埋められることになる。このため、間隙  $g$  がはんだ 220 によって埋められているか否かを目視によって観察することにより、実装（接合）状態の良否を容易に判断することができる。

#### 【0070】

図 19 は、第 5 実施形態を説明する分解斜視図であって、図 1 に対応した図である。ただし、図 19 においては、積層リードフレーム 50E が図 1 に対して平面内で 90° 回転した状態となっている。図 19 (1) において、圧電発振器 1E は、パッケージ 20 内に圧電振動片 12 を収納した圧電振動子 10 と、発振回路などが形成してある IC60 とが積層リードフレーム 50E によって一体化することにより形成される。積層リードフレーム 50E は、一方側となる上側リードフレーム 30E と、他方側となる下側リードフレーム 40E とからなる。

#### 【0071】



上側リードフレーム 30E によって形成した 4 つの接続用リード 32E は、それぞれパッド部 34E と傾斜部 35E と接続端子 36E とを有する。そして、接続端子 36E には、パッケージ 20 の底面に設けた本図に図示しない外部電極を介して、圧電振動子 10 が実装（接合）される。また、接続用リード 32E は、傾斜部 35E に切り欠き（凹部） 37E を有する。この切り欠き 37E は、樹脂パッケージ 70 を形成する際に、樹脂を入り込ませるためのもので、切り欠き 37E に入り込んだ樹脂のアンカー効果により、接続用リード 32E が樹脂パッケージから抜けて脱落するのを防止する。

#### 【0072】

下側リードフレーム 40E によって形成した実装用リード 42E は、図 19（1）の D-D 線に沿った断面図である同図（2）に示したように、パッド部 44E と傾斜部 45E と実装端子 46E とを有する。そして、実装用リード 42E は、実装端子 46E より基端側となる傾斜部 45E からパッド部 44E にかけてとパッド部 44E とに、樹脂パッケージ 70 を構成する樹脂を入り込ませる切り欠き（凹部） 48E が設けてある。また、樹脂パッケージ 70 は、実装端子 46E の主面 230 が露出するように形成される。したがって、実装端子 46E は、主面 230 がはんだを介して実装基板の電極パターンに接合できるようになっている。なお、この実施形態においては、図 19（1）の右側の実装用リード 42E は、実装基板のグランド端子に接続するようになっていて、ダイパッド 52E と一体に形成してある。

#### 【0073】

下側リードフレーム 40E によって形成した調整端子 54E は、この実施形態の場合、図 19（1）の左右方向に位置する実装用リード 42E、42E 間に配置してある。調整端子 54E は、先端端子部 51E と、先端端子部 51E と一体の基端部 53E とからなり、T 字状に形成してある。すなわち、調整端子 54E は、基端部 53E の幅（図 9（1）の左右方向の長さ）を有するリード片の先端側の両側を切り欠いて切り欠き部 57E を形成して T 字状に形成したものである。なお、この実施形態に示した調整端子 54E は、圧電発振器 1E の調整工程が終了し、先端端子部 51E の先端側の不要部が切断された状態を示しており、図

19 (3) に示したように、基端部 53E が樹脂パッケージ 70 の内部に埋め込まれる。

#### 【0074】

このようになっている第5実施形態においては、接続用リード 32E、実装用リード 42E に切り欠き 37E、48E が形成されているため、これらの切り欠きに 37E、48E に樹脂パッケージ 70 を構成するモールド樹脂が入り込む。このため、接続用リード 32E、実装用リード 42E は、樹脂パッケージ 70 から抜けるのを防止することができ、接合強度を大きくできる。また、調整端子 54E は、樹脂に埋め込まれる基端部 53E が先端端子部 51E より幅が広く形成してあるため、樹脂パッケージ 70 から抜けることがない。したがって、圧電発振器 1E は、樹脂パッケージの樹脂とリード、端子との接合が剥離するのを防止することができ、耐衝撃性を向上することができる。

#### 【0075】

図 20 は、第6実施形態に係る圧電発振器の分解斜視図である。この第6実施形態の圧電発振器 1F は、積層リードフレーム 50F を構成している下側リードフレーム 40F が第5実施形態の下側リードフレーム 40E と異なっていて、他は第5実施形態と同様である。この第6実施形態に係る下側リードフレーム 40F は、実装用リード 42F が傾斜部を有していない。すなわち、実装用リード 42F は、折曲されておらず、パッド部 44F と実装端子 46F との上面が同一平面内に位置している。ただし、実装用リード 42F は、図 20 (1) の E-E 線に沿った断面図である同図 (2) に示したように、基端側となるパッド部 44F が実装端子 46F より薄肉に形成してある。このため、実装用リード 42F は、実装端子 46F の主面 230 とパッド部 44F の下面 232 との間に段差部 234 が形成されている。また、パッド部 44F には、第5実施形態に示したと同様の切り欠き 48E が設けてある。下側リードフレーム 40F の他の構成は、第5実施形態と同様である。なお、実装用リード 42F は、プレスによる塑性加工やエッチングなどによってパッド部 44F を薄肉化することにより、容易に形成することができる。

#### 【0076】

このようになっている第5実施形態の実装用リード42Fにおいては、パッド部44Fと実装端子46Fとの間に傾斜部を形成しないため、実装端子46Fを大きくすることができる。したがって、実装端子46Fは、実装基板との接合面積が大きくなり、実装基板との接合強度を向上することができる。また、実装用リード42Fは、傾斜部が設けられていないために厚み方向の寸法が小さくなり、圧電発振器1Fの薄型化を図ることができる。

#### 【0077】

さらに、実装用リード42Fは、傾斜部を有していないため、小型化された場合であっても、加工時や衝撃力が作用したときに破断するようなことがない。すなわち、圧電発振器が小型化、薄型化されるのに伴って、実装用リードも小型、薄肉化される。そして、実装端子を実装用リードの曲げ加工（フォーミング）によって形成する場合、傾斜部が他の部分より肉厚が薄くなる。したがって、実装用リードを曲げ加工して実装端子を形成した場合、実装用リードの曲げ加工時や、圧電発振器に衝撃力が作用して樹脂との剥離が生ずると、傾斜部において破断するおそれがある。これに対し、実施形態の実装用リード42Fは、傾斜部を有しないため、このような破断を生ずるおそれがない。

#### 【0078】

なお、下側リードフレーム40Fは、実装端子46Fの部分のみを厚肉に形成し、ダイパッドを含めて実装端子以外の部分をエッチングなどにより薄肉にしてもよい。この場合、実装端子46Fの主面230が、図20（2）に示したように、薄肉にした他の部分の下面より下方となるようにする。これにより、実装端子を折曲して形成しなくとも、実装端子46Fの主面230を露出させて樹脂モールドをしたときに、実装端子46F以外の薄肉の不要な部分は樹脂パッケージ70内に封止される。したがって、実装端子46Fを実装基板に接合したときに、他の部分が実装基板の配線パターンなどと短絡するようなことがなく、圧電発振器の薄型化を図ることができる。

#### 【0079】

なお、第6実施形態において、接続用リード32Eの代わりに、同図（3）に示したような接続用リード32Fにしてもよい。この接続用リード32Fは、パ

ッド部 3 4 F と接続端子 3 6 F との間に傾斜部が設けられておらず、パッド部 3 4 F と接続端子 3 6 F との下面が同一平面内に位置している。そして、接続用リード 3 2 F は、パッド部 3 4 F の肉厚が接続端子 3 6 F の肉厚より薄くなっている。このため、パッド部 3 4 F の上面 2 3 6 が接続端子 3 6 F の主面 2 3 8 より低くなっている。このような接続用リード 3 2 F は、接続端子 3 6 F の面積を大きくすることができ、圧電振動子 1 0 との接合強度を大きくすることができる。また、圧電発振器の薄型化が図れる。この接続用リード 3 2 F は、実装用リード 4 2 F と同様にして形成することができる。

#### 【 0 0 8 0 】

図 2 1 は、第 7 実施形態に係る圧電発振器の分解斜視図である。この圧電発振器 1 G は、積層リードフレーム 5 0 G を構成している下側リードフレーム 4 0 G、特に実装用リードの実装端子が第 5 実施形態の下側リードフレーム 4 0 G の実装端子 4 6 E と異なっている。他は、第 5 実施形態と同様である。この第 7 実施形態に係る実装用リード 4 2 G は、図 2 1 ( 1 ) の F - F 線に沿った断面図である同図 ( 2 ) に示したように、パッド部 4 4 E と傾斜部 4 5 E と実装端子 4 6 G とを有する。そして、実装端子 4 6 G は、主面 2 3 0 に凸部 2 4 0 が形成してある。また、実装端子 4 6 G は、主面 2 3 0 と反対側の樹脂との接合面 2 4 2 の、凸部 2 4 0 と対応した位置に凹部 2 4 4 が形成してある。これらの凸部 2 4 0 と凸部 2 4 4 とは、実装端子 4 6 F をプレス成形することにより、容易に形成することができる。

#### 【 0 0 8 1 】

このようになっている実装端子 4 6 G は、主面 2 3 0 に凸部 2 4 0 が形成されているため、実装基板に接合したときに、はんだとの接触面積が大きくなるとともに、凸部 2 4 0 によるアンカー効果により、実装基板との接合強度を向上することができる。また、実装端子 4 6 G は、樹脂との接合面 2 4 2 に凹部 2 4 4 が形成してあるため、樹脂との実質的な接合面積が大きくなるとともに、凹部 2 4 4 に樹脂が入り込むため、樹脂との接合強度を高めることができる。

#### 【 0 0 8 2 】

なお、実装端子は、図 2 1 ( 1 ) の右側に示した実装用リード 4 2 H のように

形成してもよい。すなわち、実装用リード42Hは、図21(1)のG-G線に沿った断面図である同図(3)に示したように、実装端子46Hの主面230に凹部246が形成してある。また、実装端子46Hは、主面230の反対側の樹脂との接合面242に凸部248が形成してある。主面230側の凹部246と、接合面242側の凸部248とは対応していて、プレスによる曲げ加工などにより形成される。このように形成した実装端子46Hは、同図(2)の実装端子46Gと同様の効果を得ることができる。

#### 【0083】

さらに、実装用リードは、図22のように形成することができる。図22に示した実装用リード42Jは、厚さtのリード片のパッド部44Jの下面側と、実装端子46Jの上面側とをエッチングし、クランク状に形成したものである。この実装用リード42Jにおいても、実装端子46Jの面積を大きくすることができ、厚み方向の寸法を小さくすることができる。

#### 【0084】

なお、第7実施形態においては、実装端子に凸部または凹部を1つ設けた場合について説明したが、これらは複数設けることができる。また、接続用リード32Eに代えて、図23に示した接続用リードのように形成してもよい。図23(1)に示した接続用リード32Gは、接続端子36Gの、圧電振動子10を接合する主面238に凸部250が設けてある。そして、接続端子36Gは、主面238と反対側の樹脂との接合面に凹部(図示せず)が形成してある。このように形成した接続端子36Gは、圧電振動子10との接合強度、および樹脂パッケージの樹脂との接合強度を向上することができる。

#### 【0085】

図23(2)に示した接続用リード32Hは、接続端子36Hの主面238に凹部252が形成してあり、その反対側の樹脂との接合面に凸部254が形成してある。また、同図(3)に示した接続用リード32Jは、接続端子36Jの主面238に凹部256が形成され、その反対側の面に凸部258が形成されている。そして、凹部256は、接続端子36Jの先端側において開口していて、U字状をなしている。これらの接続端子36H、36Jも接続端子36Gと同様の

効果が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】 第 1 実施形態に係る圧電発振器を分解した状態の斜視図である。

【図 2】 第 1 実施形態に係る圧電発振器の側面断面図である。

【図 3】 リードフレームの平面図である。

【図 4】 パッケージのキャストレーション部分の斜視図である。

【図 5】 実装端子の説明図である。

【図 6】 周波数調整工程の説明図である。

【図 7】 第 1 実施形態に係る圧電発振器を分解した状態の斜視図である。

【図 8】 配線状態の説明図である。

【図 9】 従来技術に係る圧電発振器の説明図である。

【図 1 0】 第 3 実施形態のリードフレームの説明図である。

【図 1 1】 第 3 実施形態のリードフレームにおける樹脂封止の説明図である。

【図 1 2】 実施形態の押え代を切断する方法の説明図である。

【図 1 3】 第 3 実施形態に係る圧電発振器の説明図である。

【図 1 4】 第 3 実施形態の圧電発振器の実装状態を示す図である。

【図 1 5】 第 4 実施形態のリードフレームの説明図である。

【図 1 6】 第 4 実施形態のリードフレームにおける樹脂封止の説明図である。

【図 1 7】 第 4 実施形態の圧電発振器の説明図である。

【図 1 8】 第 4 実施形態に係る圧電発振器の実装方法の説明図である。

【図 1 9】 第 5 実施形態に係る圧電発振器の分解斜視図である。

【図 2 0】 第 6 実施形態に係る圧電発振器の分解斜視図である。

【図 2 1】 第 7 実施形態に係る圧電発振器の分解斜視図である。

【図 2 2】 他の実施形態に係る実装用リードの説明図である。

【図 2 3】 他の実施形態に係る接続用リードの説明図である。

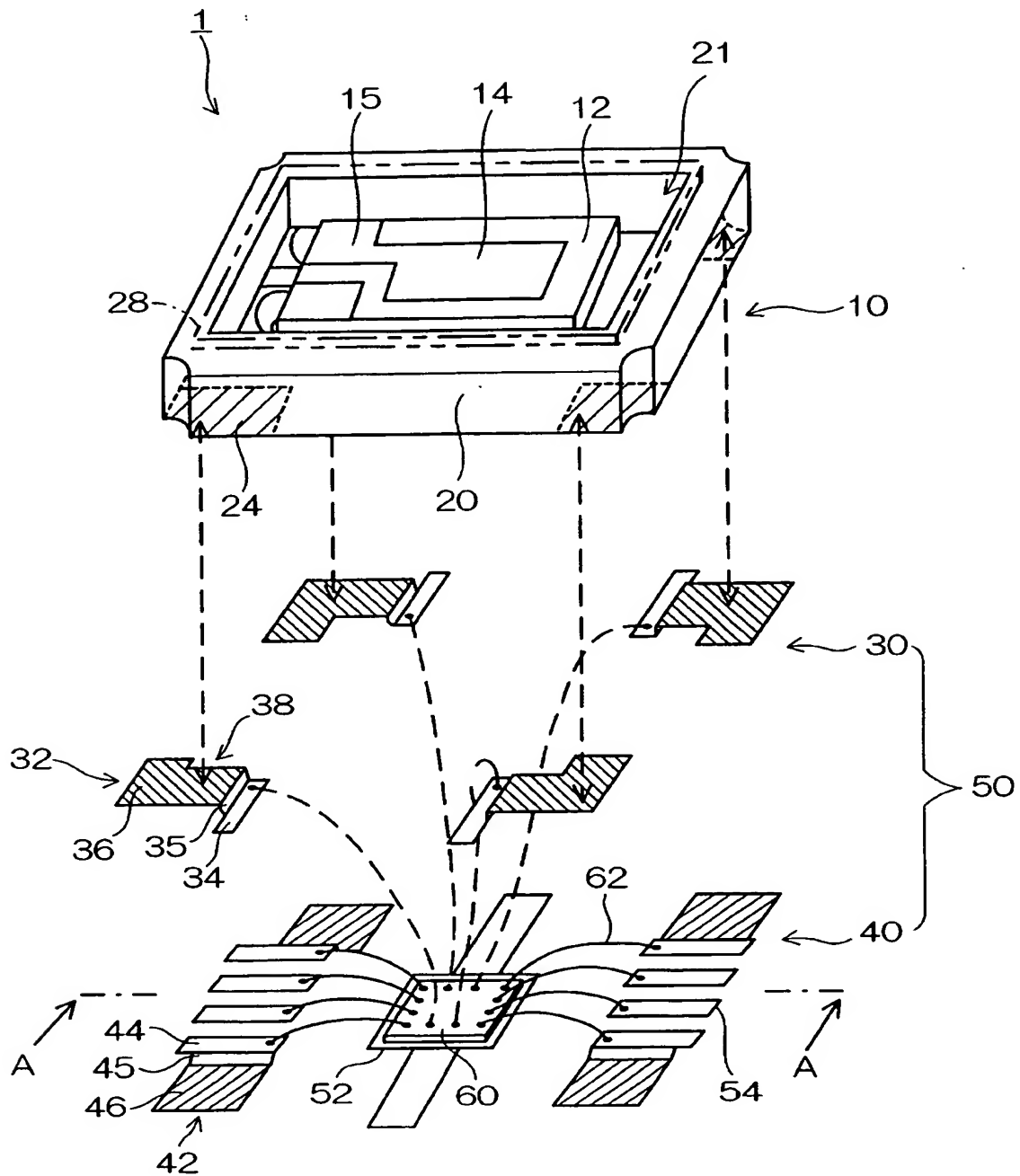
【符号の説明】

1、1 E ～ 1 G ……圧電発振器、1 0 ……圧電振動子、1 2 ……圧電振

動片、1 4 ……励振電極、1 5 ……接続電極、2 0 ……パッケージ、2 4 ……外部電極、3 0 ……上側リードフレーム、3 2、3 2 E ～ 3 2 H、3 2 J ……接続用リード、3 4 ……パッド、3 5 ……傾斜部、3 6、3 6 E ～ 3 6 H、3 6 J ……接続端子、3 8、3 7 E、4 8 E、5 7 E ……切り欠き、4 0、4 0 A、4 0 B、4 0 E ～ 4 0 G ……下側リードフレーム、4 2、4 2 A、4 2 B、4 2 E ～ 4 2 H、4 2 J ……実装用リード、4 4 ……パッド、4 5 ……傾斜部、4 6、4 6 A、4 6 B、4 6 E ～ 4 6 H、4 6 J ……実装端子、5 0 ……積層リードフレーム、5 2 ……ダイパッド、5 4、5 4 E ……調整端子、6 0 ……I C、6 2 ……ワイヤ、7 0 ……樹脂パッケージ。

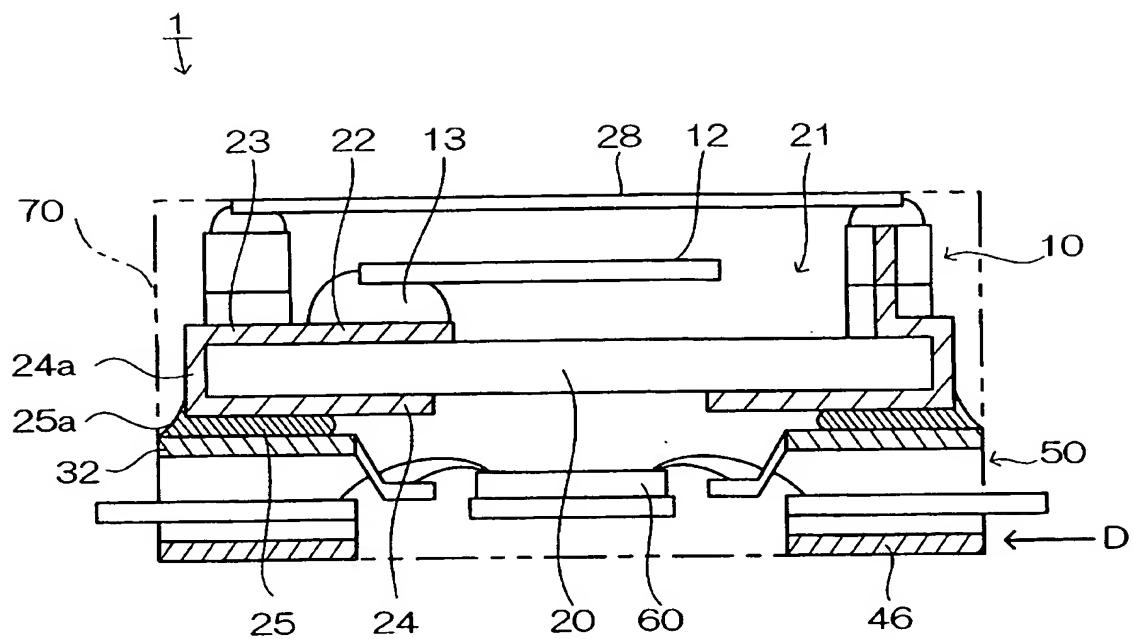
【書類名】 図面

【図 1】

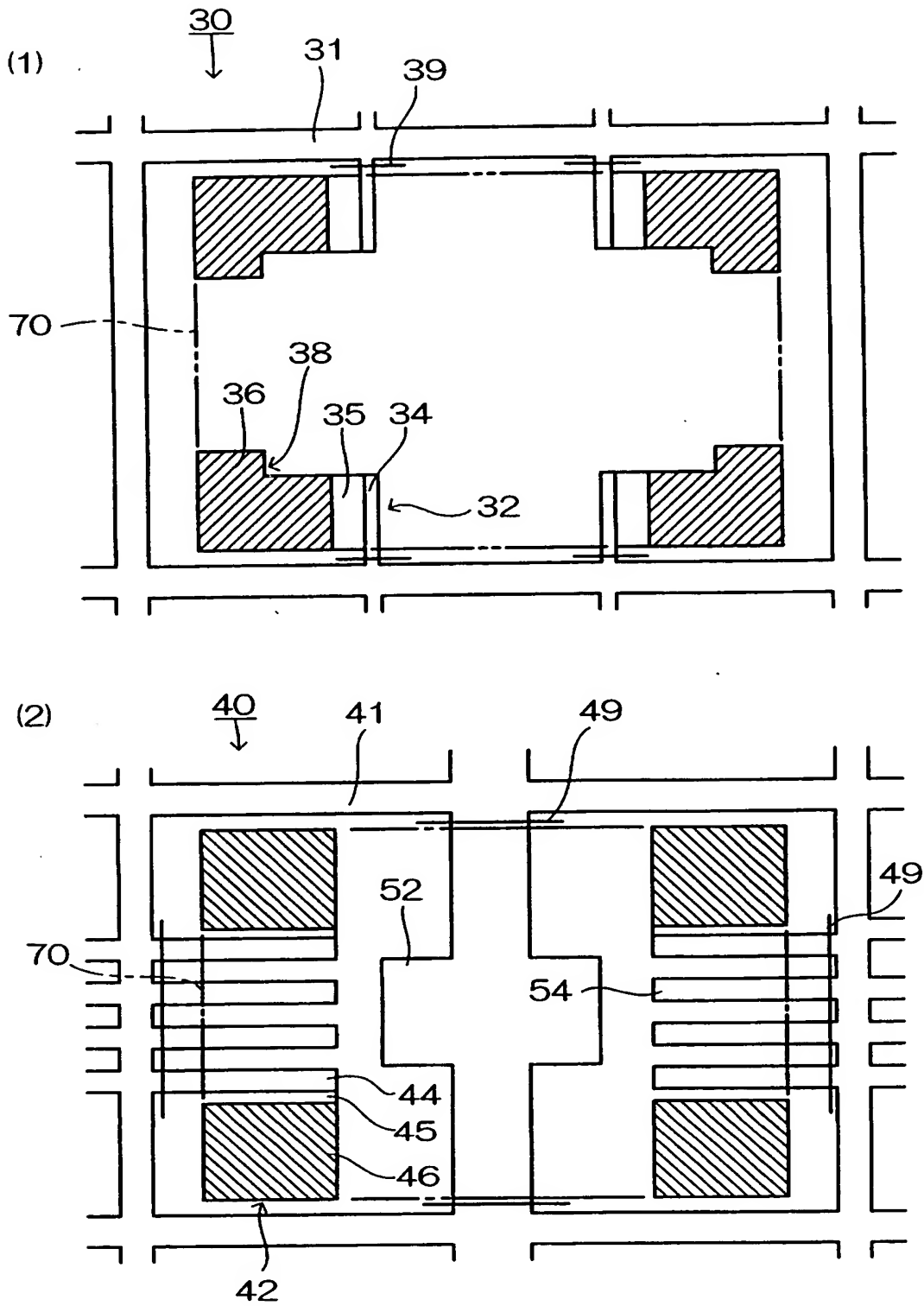




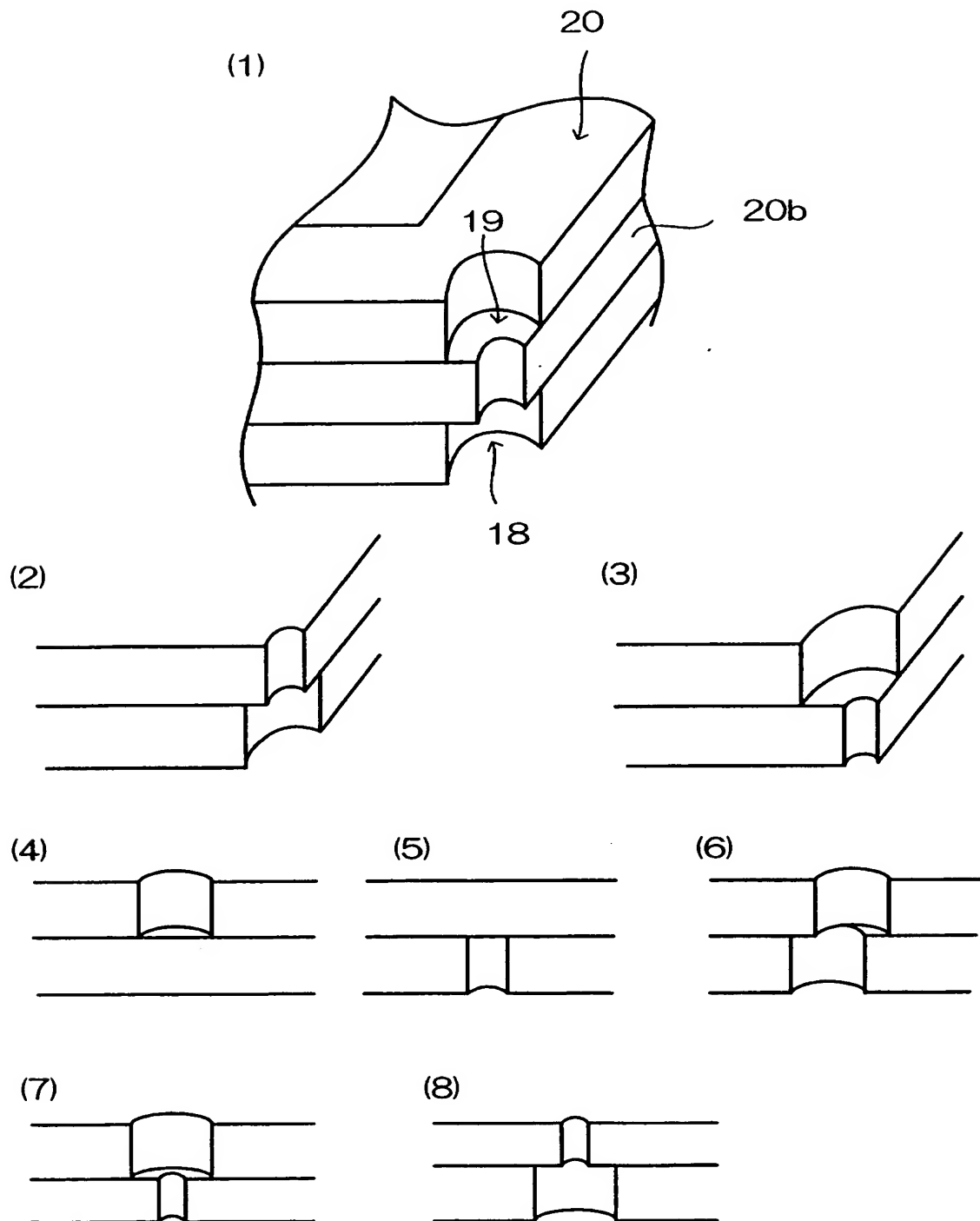
【図 2】



【図 3】

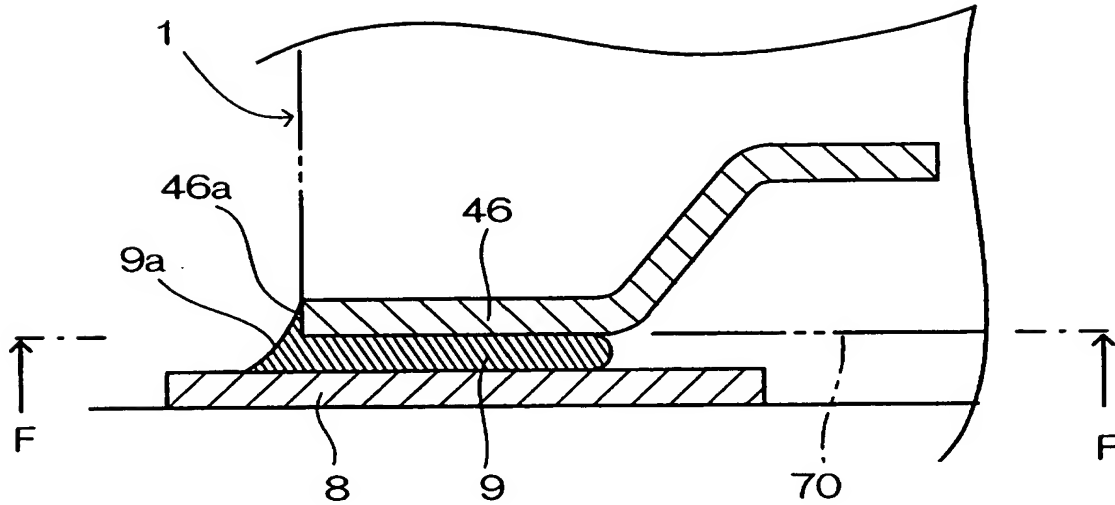


【図 4】

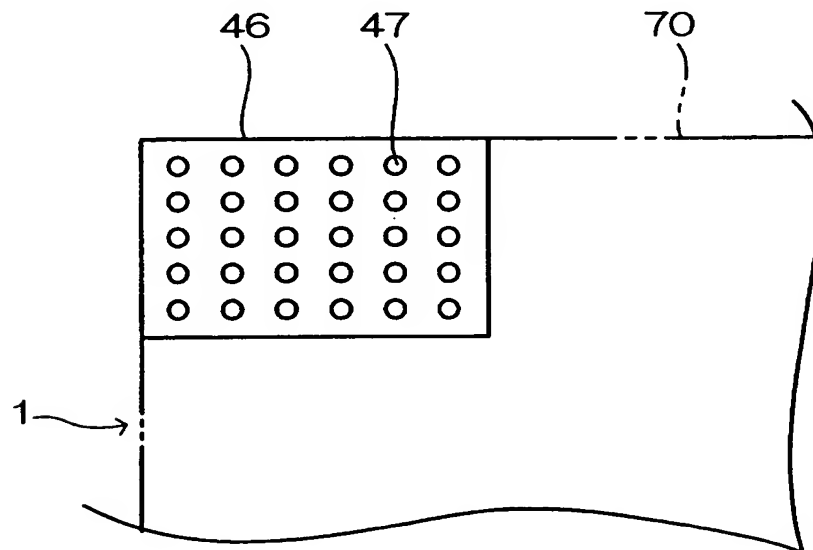


【図 5】

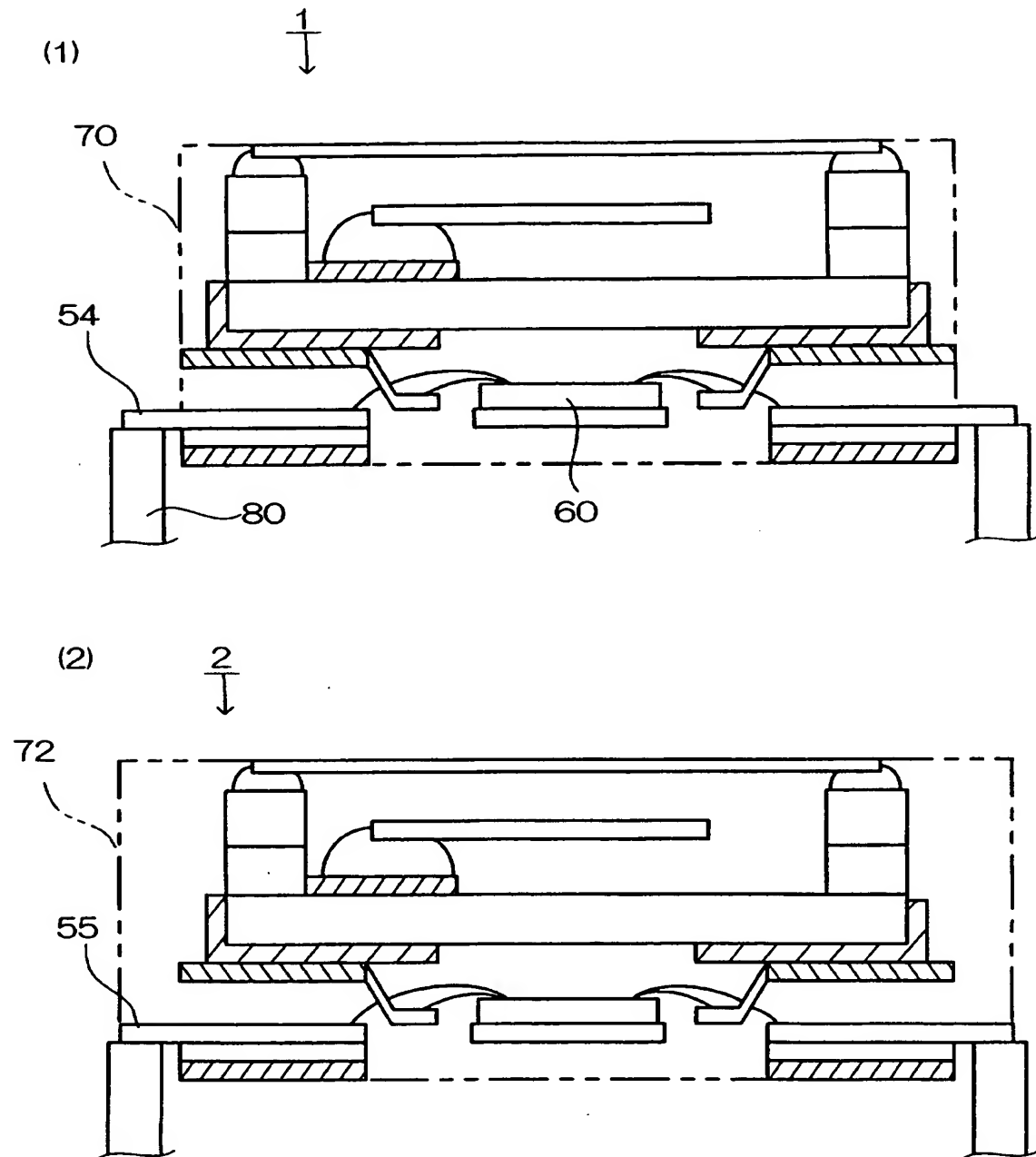
(1)



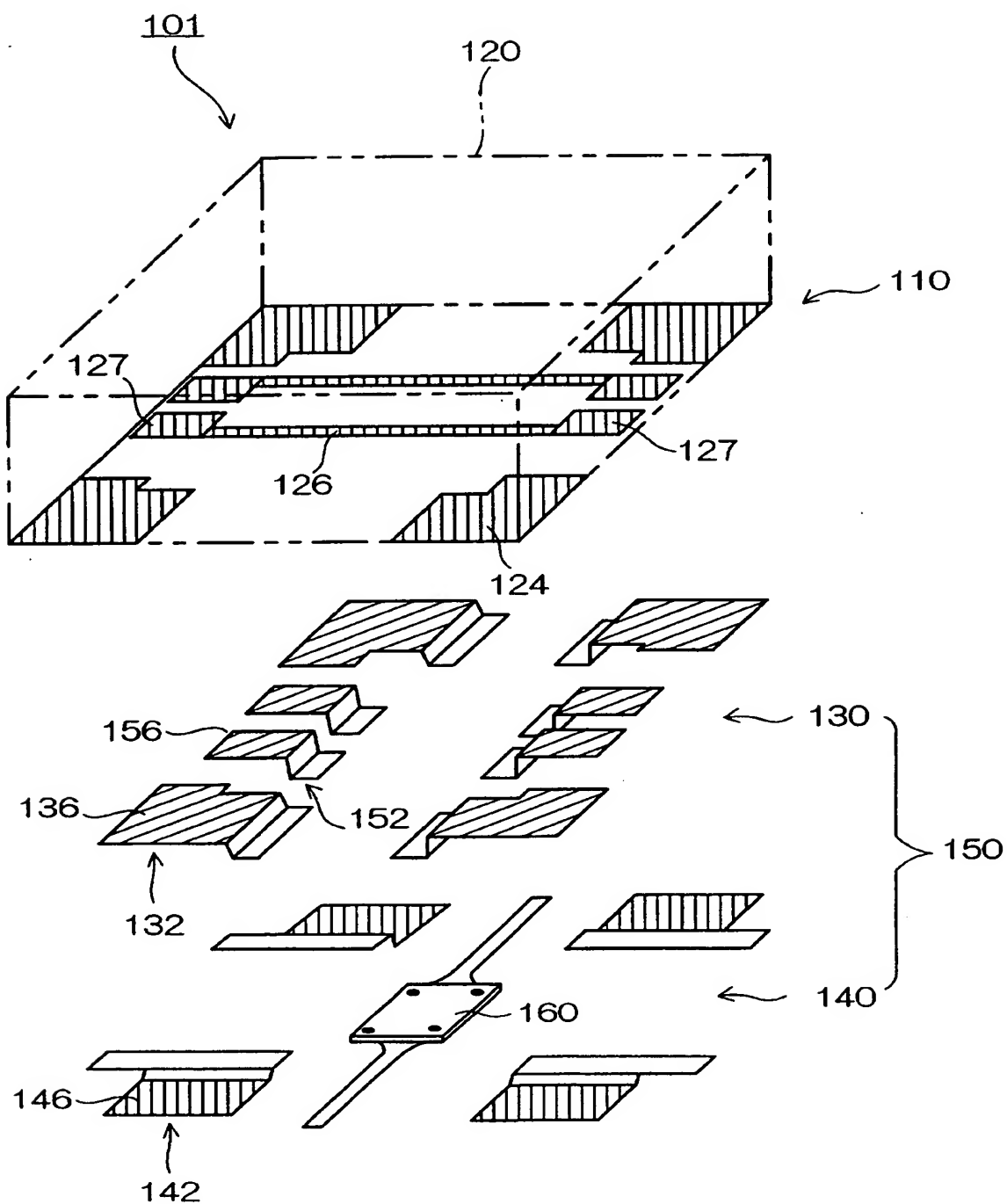
(2)



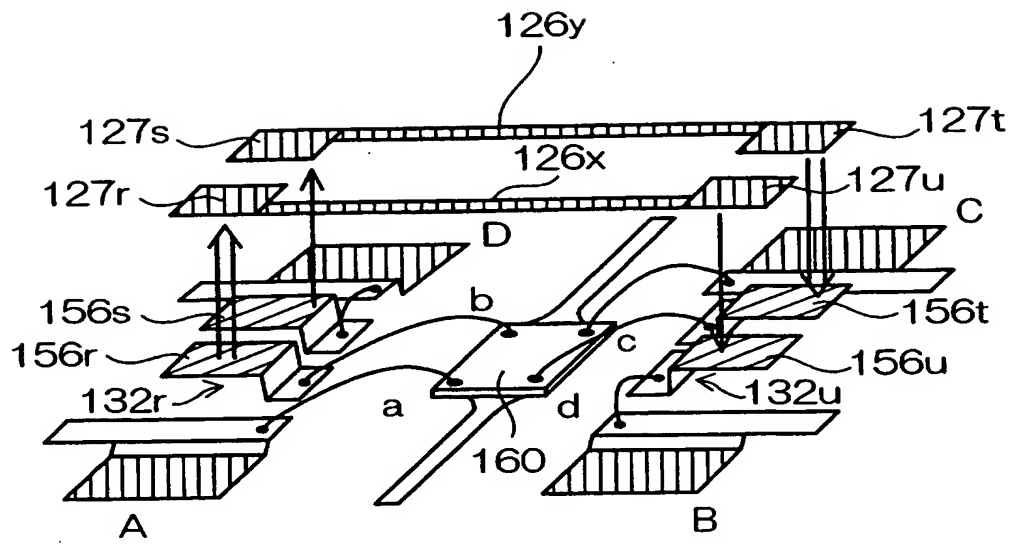
【図 6】



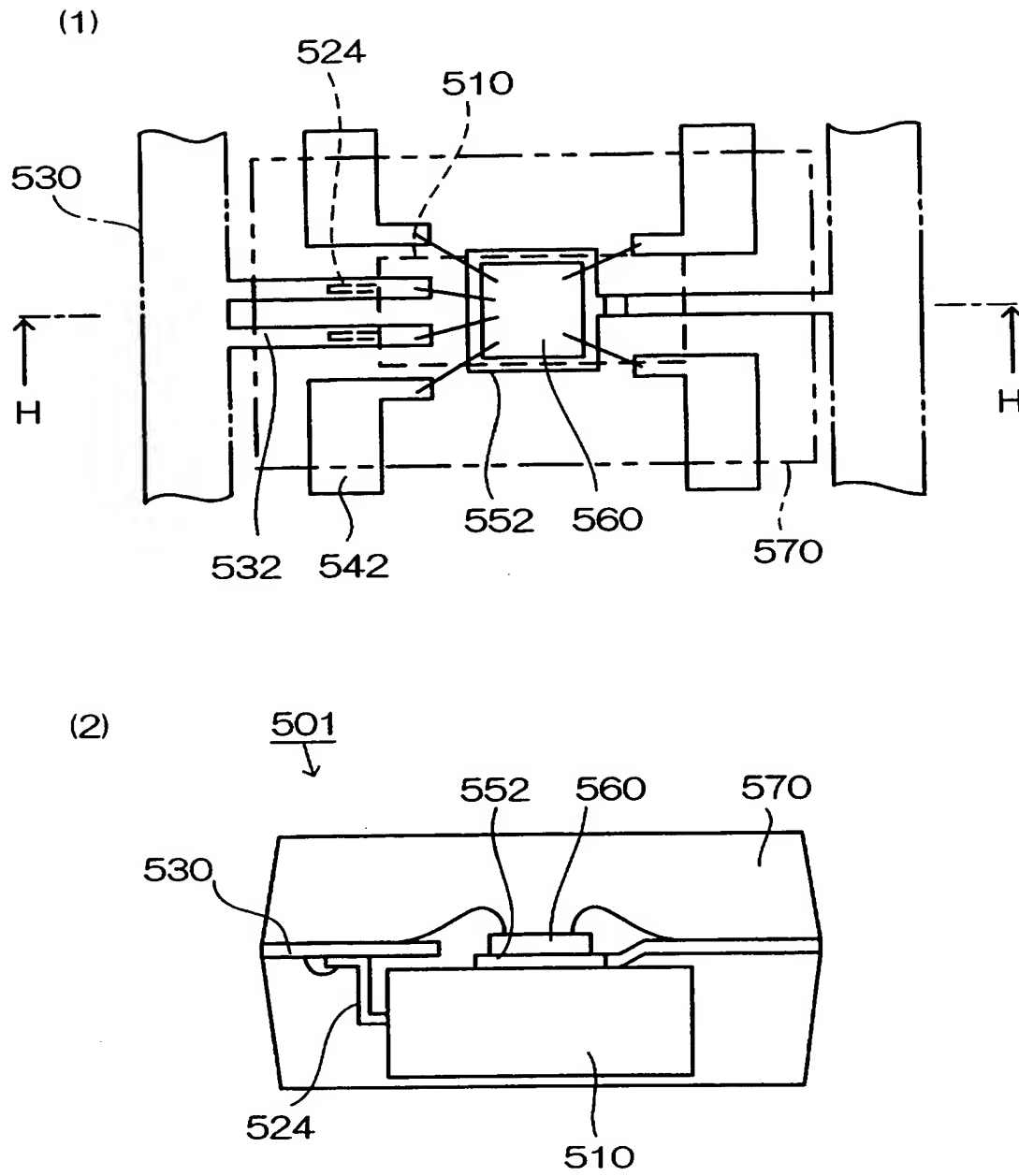
【図 7】



【図 8】

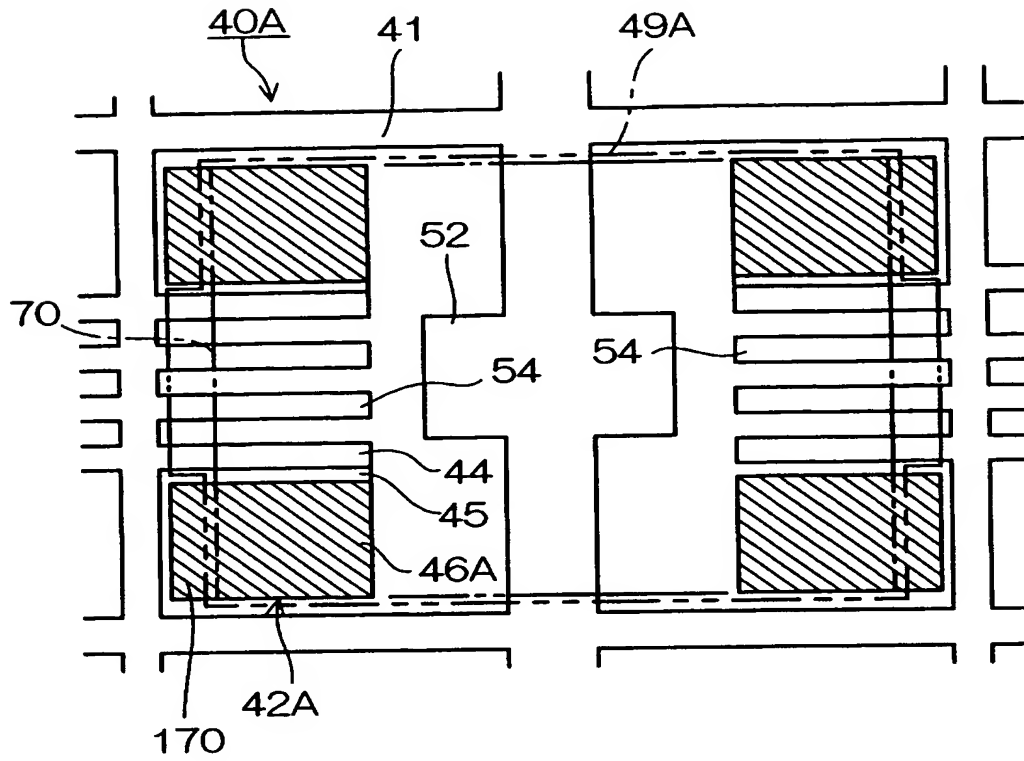


【図 9】



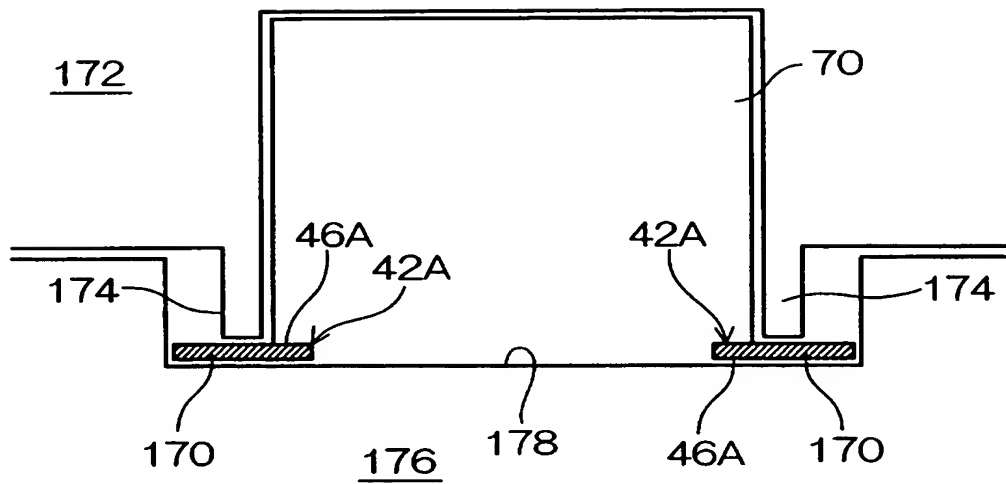


【図 10】

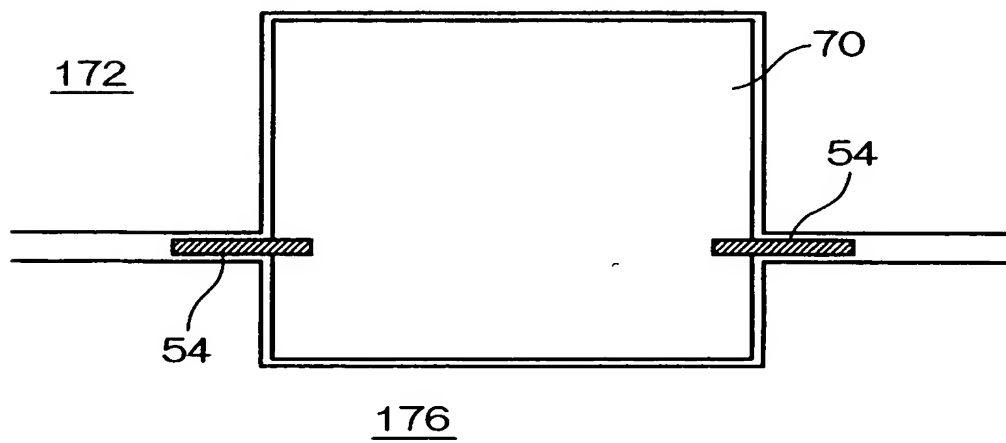


【図 11】

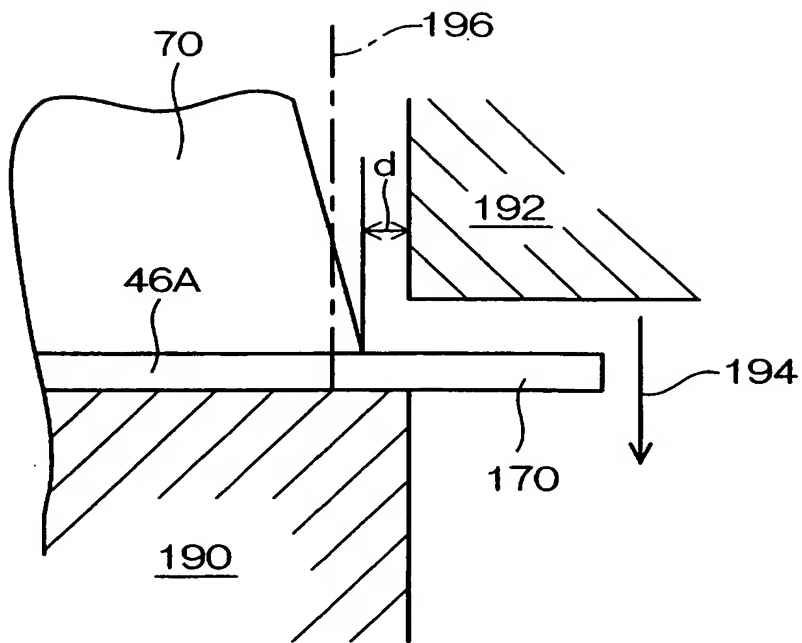
(1)



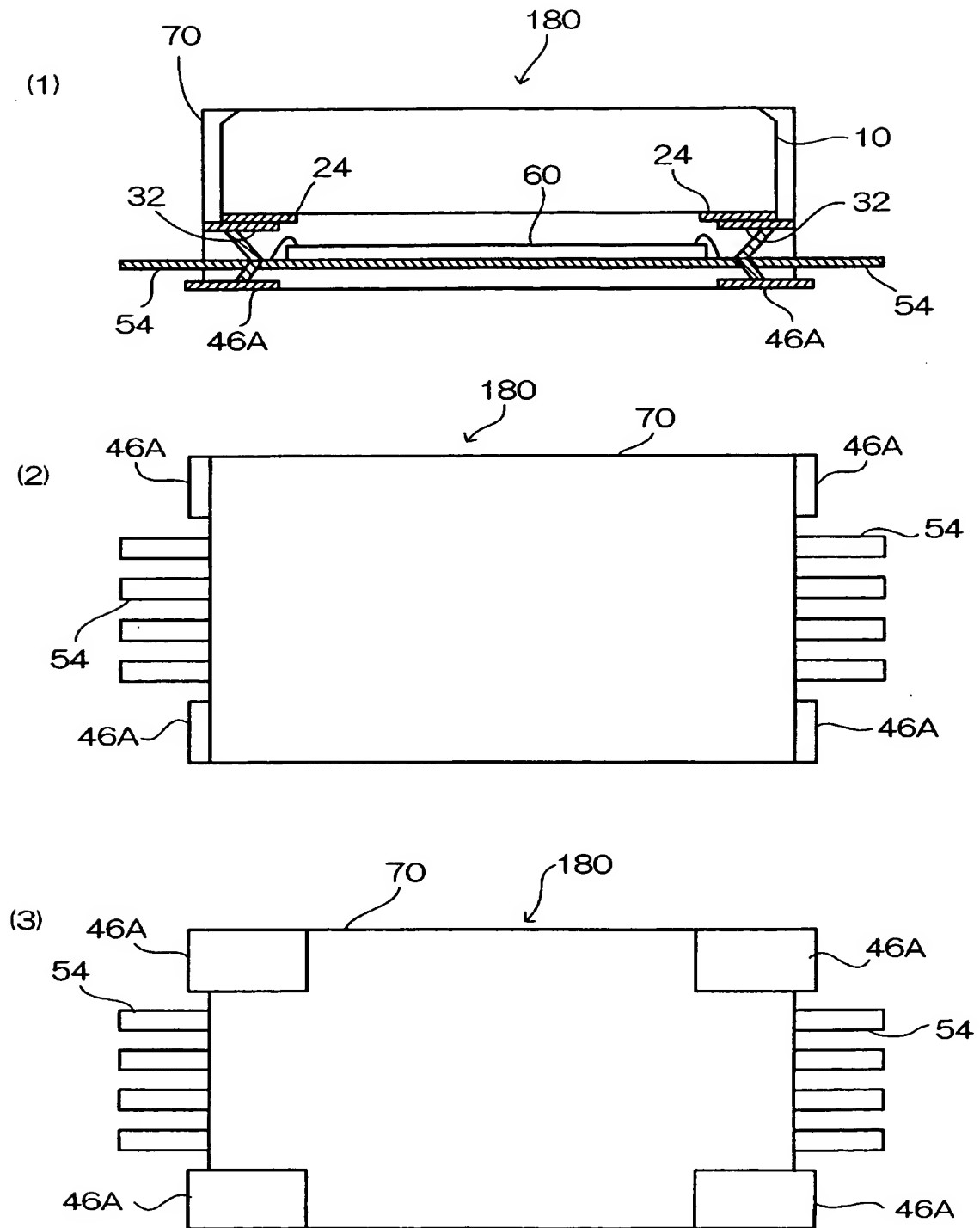
(2)



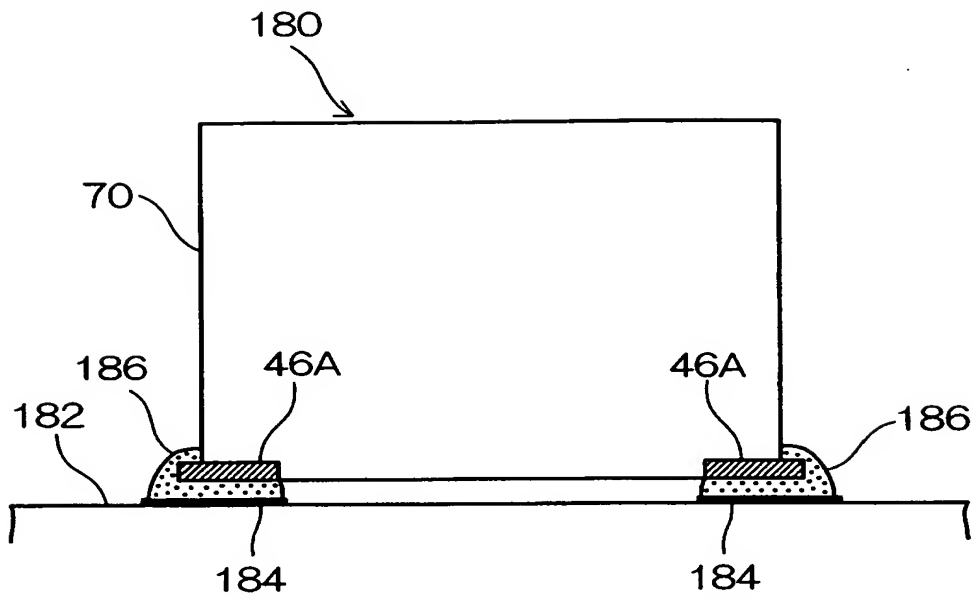
【図 12】



【図 13】

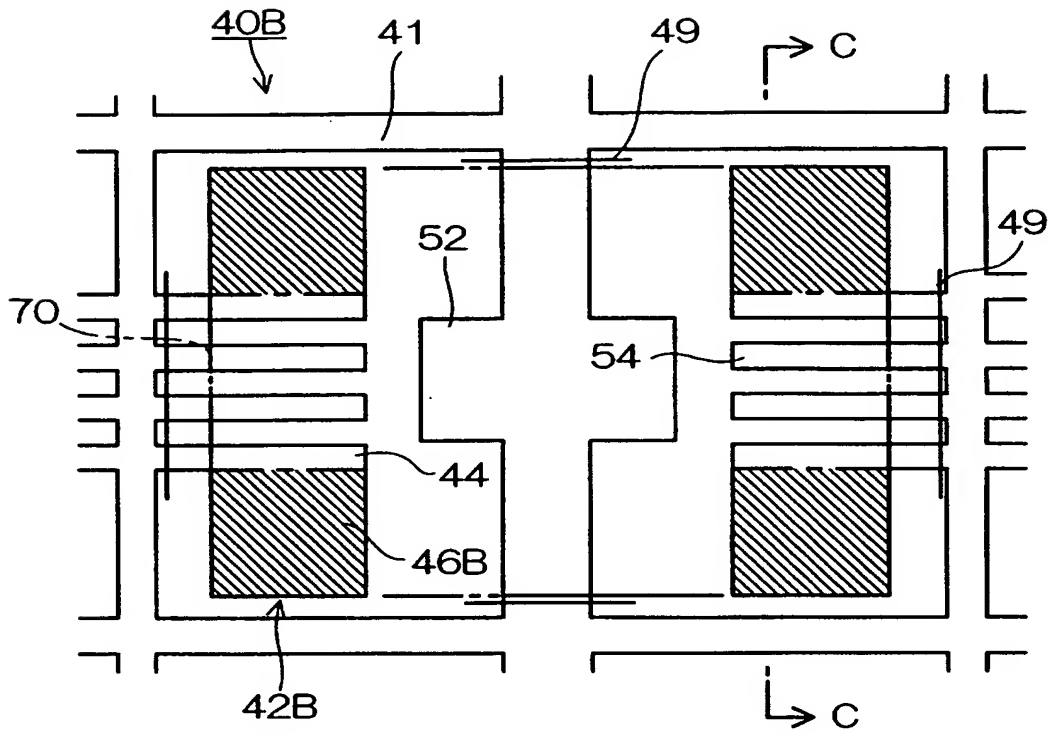


【図 14】

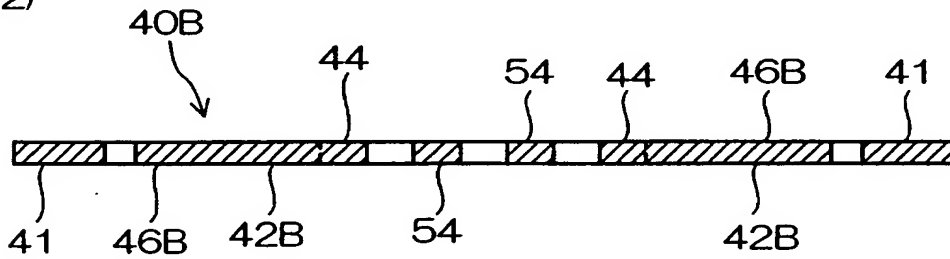


【図 15】

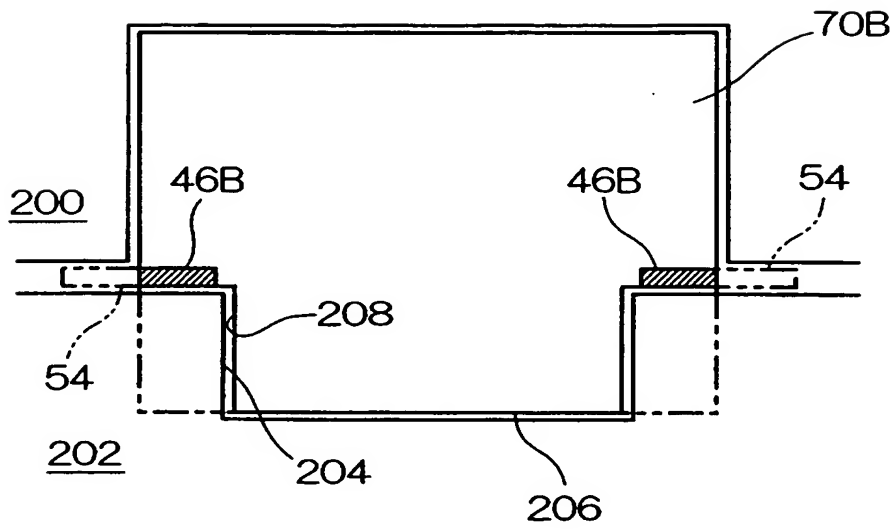
(1)



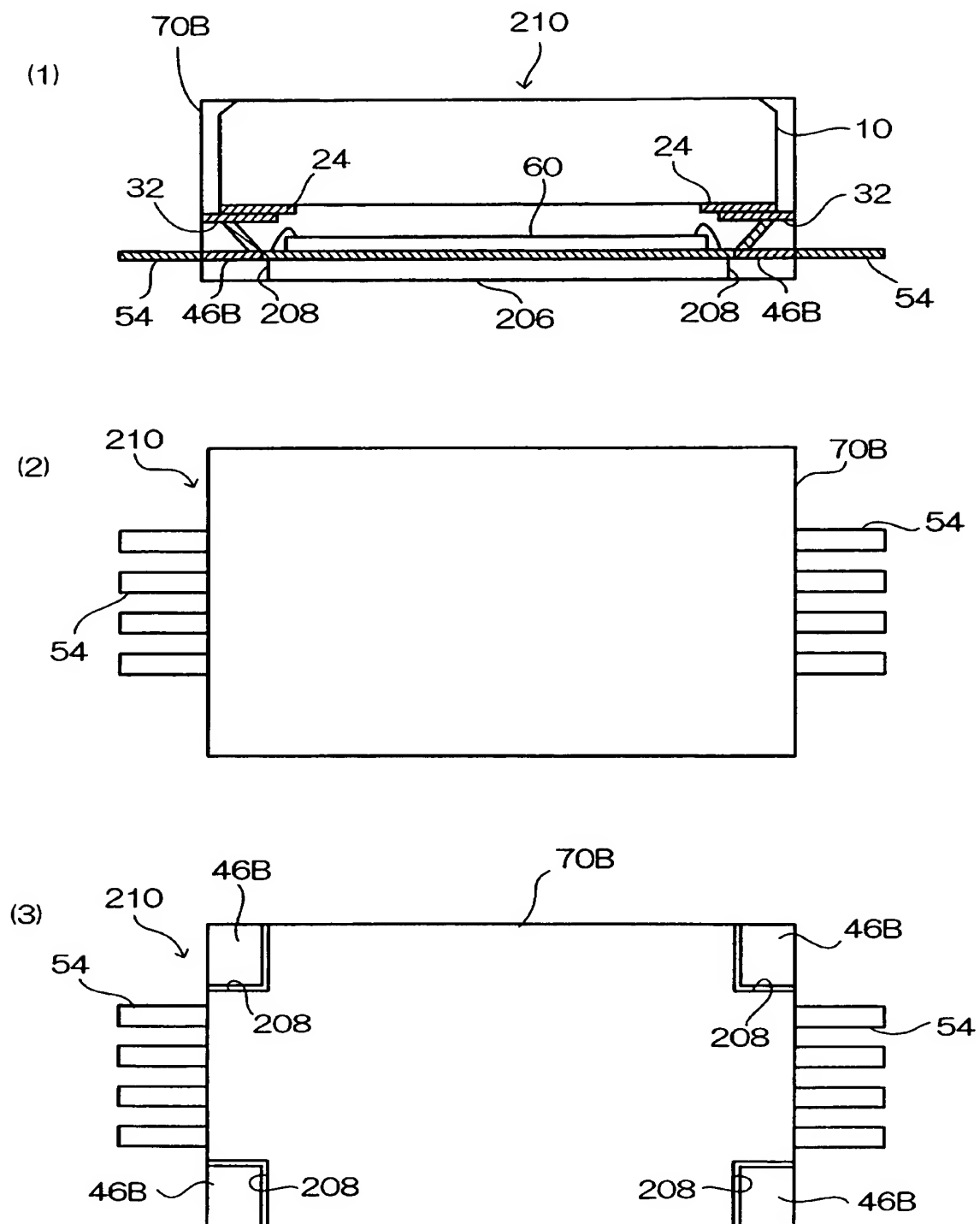
(2)



【図 16】

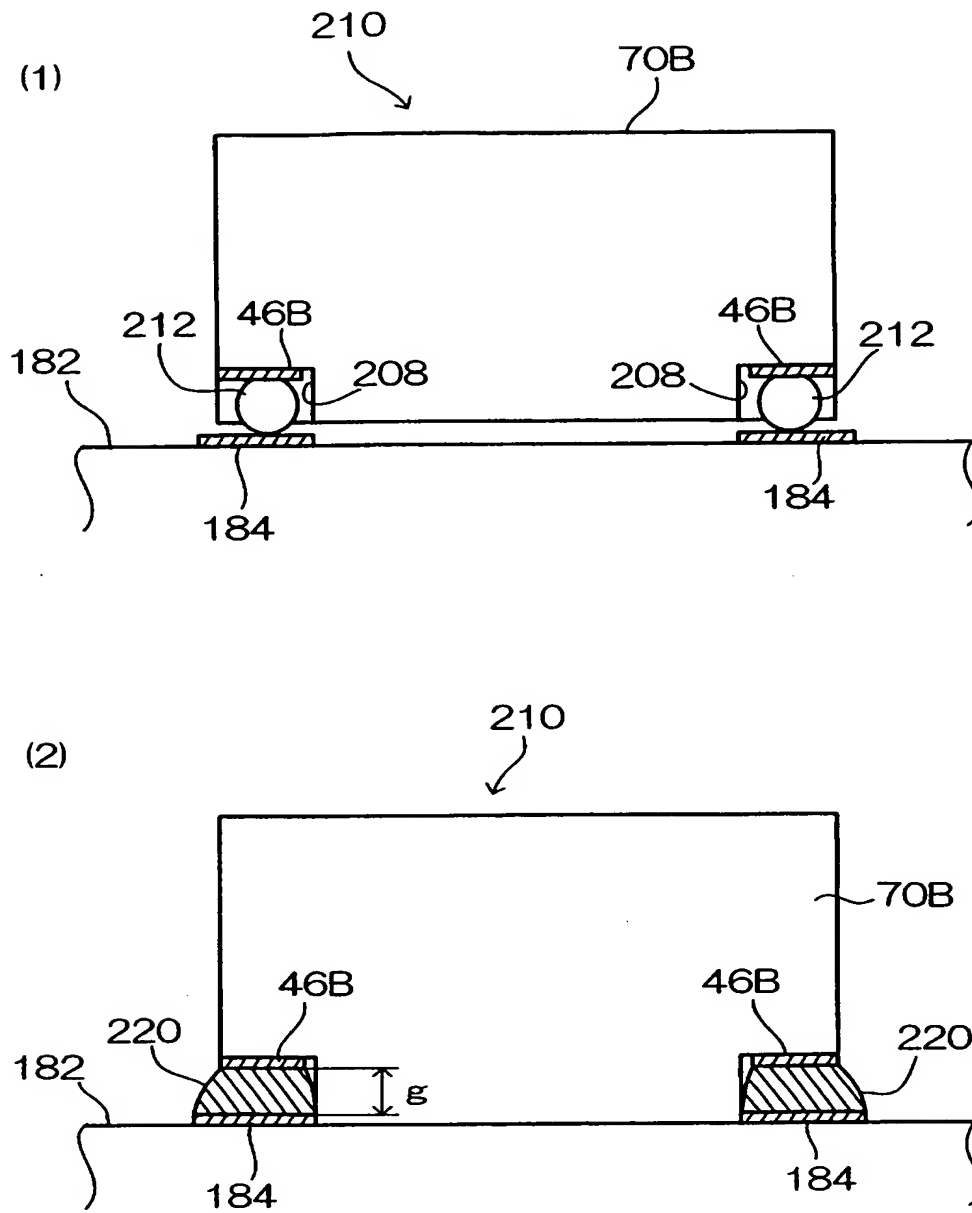


【図 17】

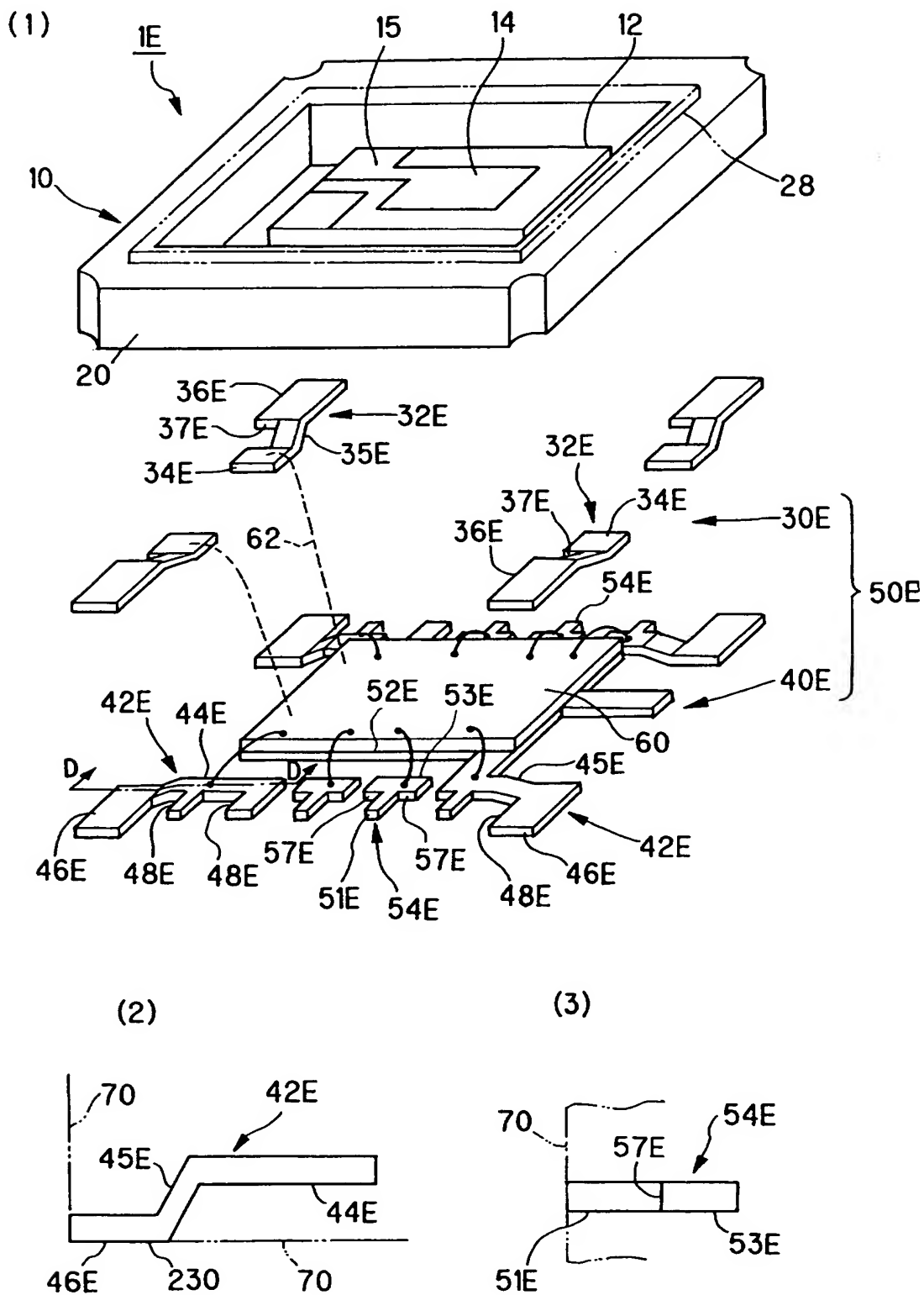




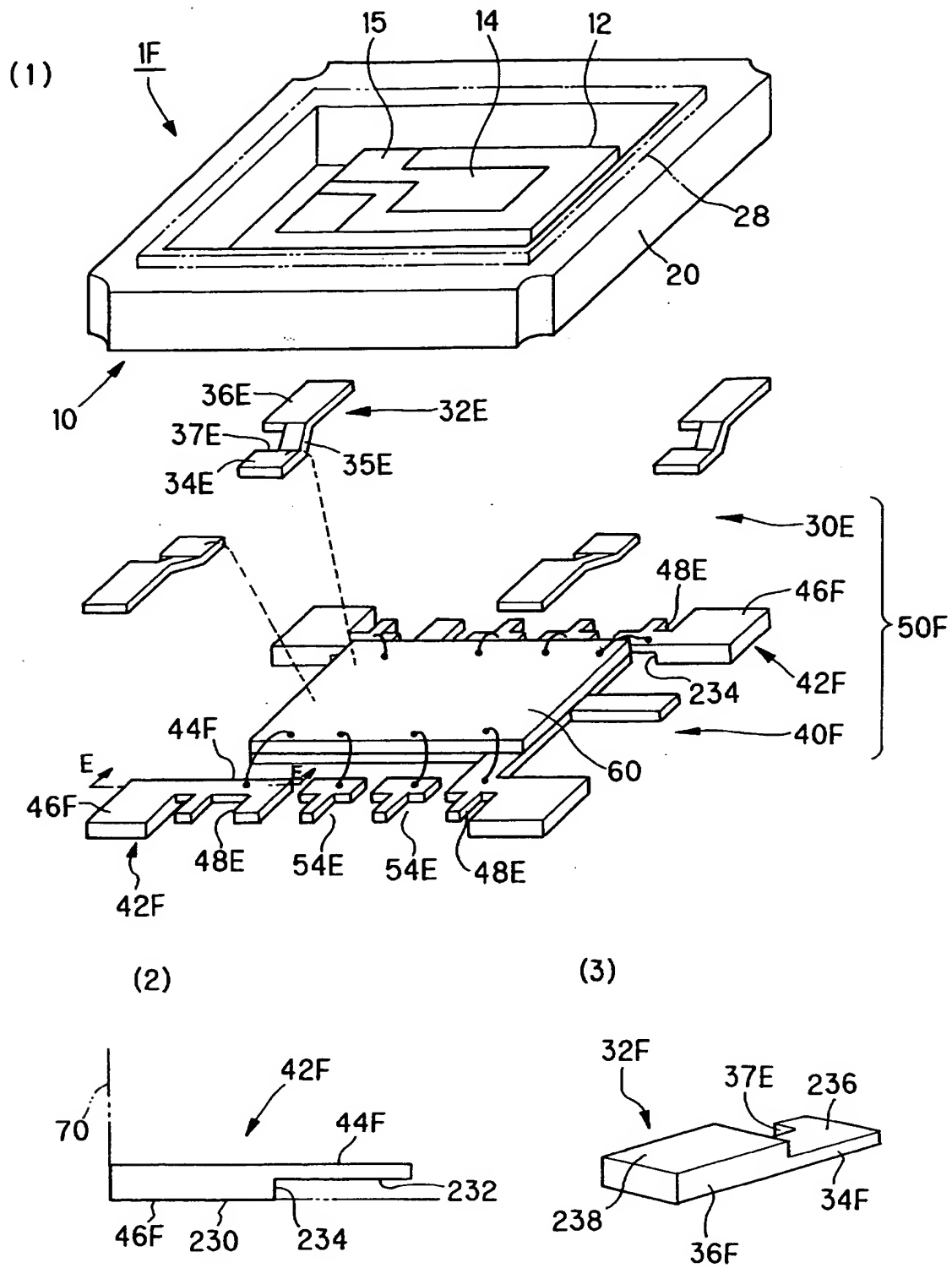
【図 18】



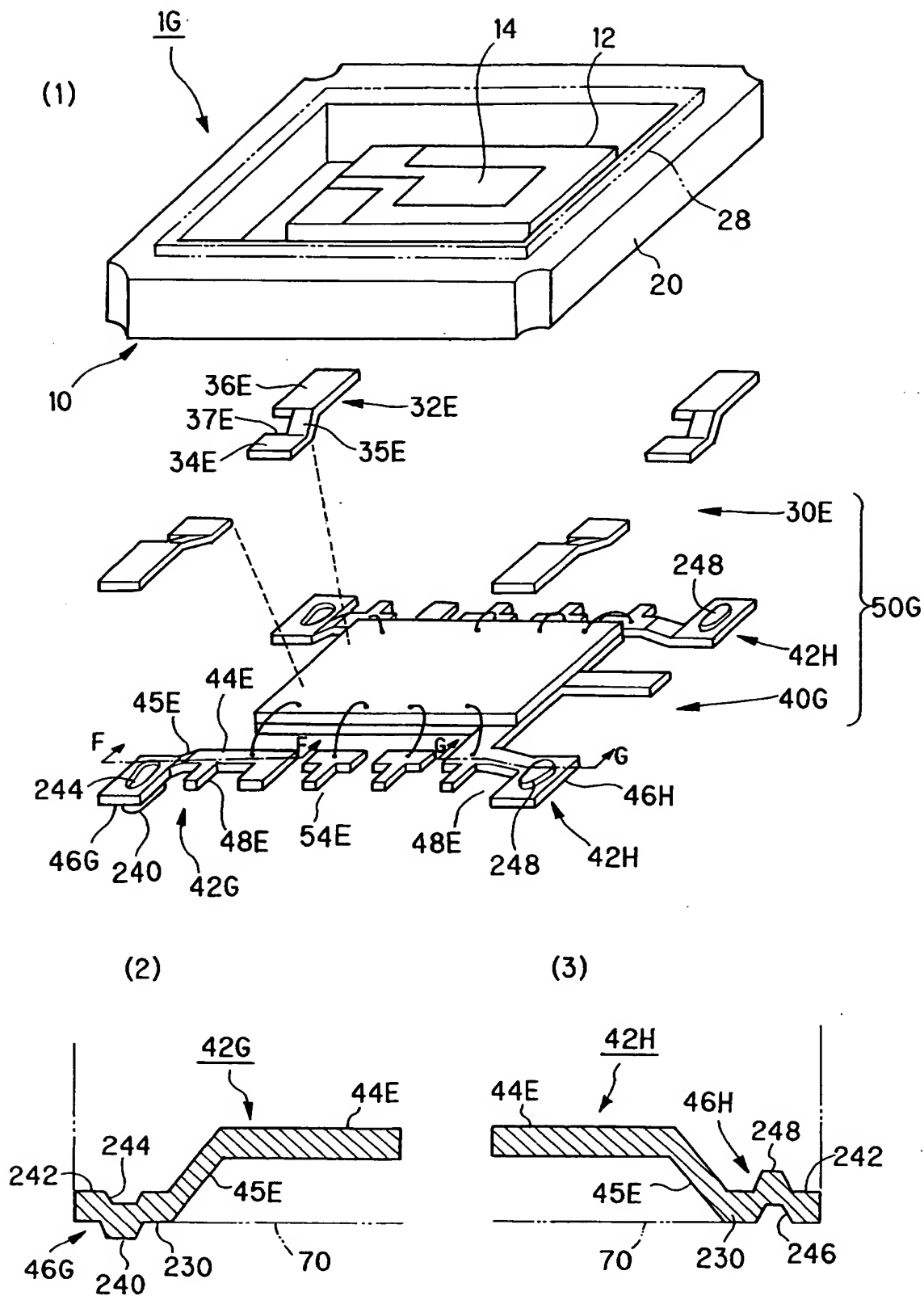
【図 19】



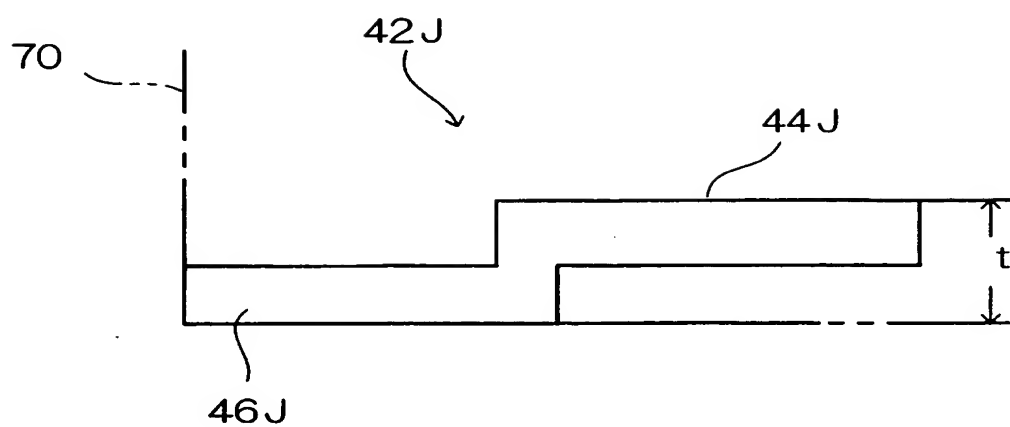
【図 20】



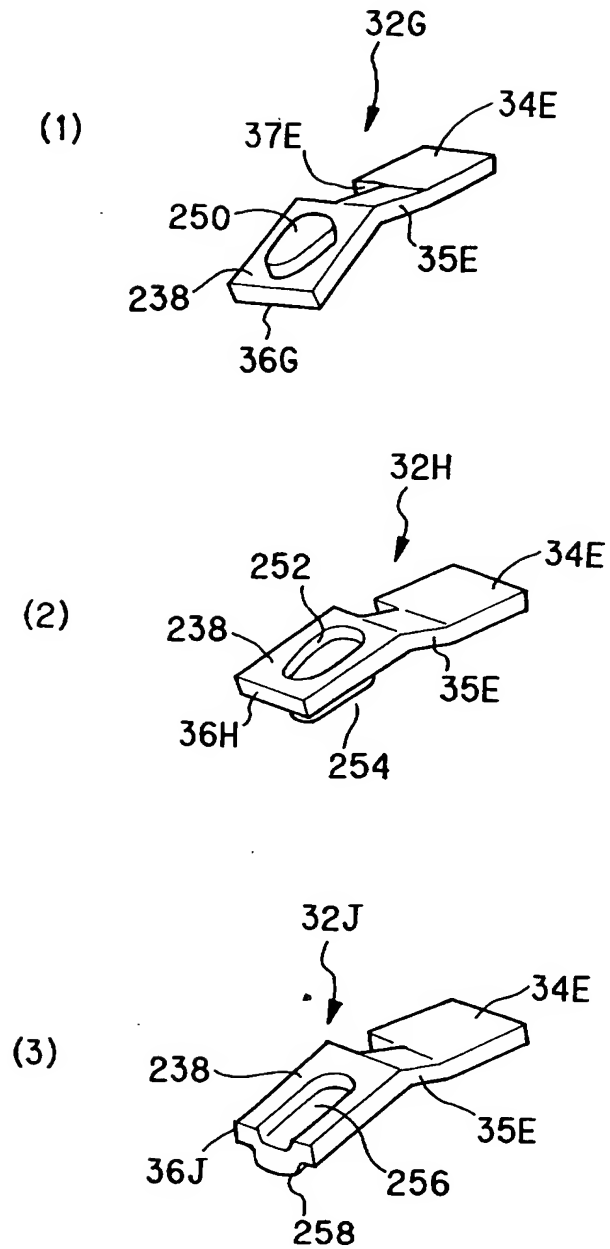
【図 21】



【図 22】



【図 23】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 平面サイズを小さくすることにより小型化が可能な圧電発振器を提供する。

【解決手段】 2枚のリードフレーム30、40で構成される積層リードフレーム50につき、圧電振動子10との接続用リード32を上側リードフレーム30に形成し、その接続用リード32を上側に立ち上げて接続端子36を形成するとともに、実装基板への実装用リード42を下側リードフレーム40に形成し、その実装用リード42を下側に立ち上げて実装端子46を形成し、発振回路を形成したIC60を積層リードフレーム50に実装し、パッケージ20の内部に圧電振動片12を封止した圧電振動子10を積層リードフレーム50に実装し、前記実装端子46の主面を露出させつつ、積層リードフレーム50および圧電振動子10を樹脂パッケージの内部に封止して形成した。

【選択図】 図1

## 認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 3 - 1 7 1 1 9 5
受付番号	5 0 3 0 1 0 0 4 9 2 4
書類名	特許願
担当官	第七担当上席 0 0 9 6
作成日	平成 1 5 年 7 月 7 日

## &lt; 認定情報・付加情報 &gt;

## 【特許出願人】

【識別番号】	000002369
【住所又は居所】	東京都新宿区西新宿 2 丁目 4 番 1 号
【氏名又は名称】	セイコーエプソン株式会社

## 【代理人】

申請人

【識別番号】	100091306
【住所又は居所】	東京都豊島区西池袋 5 - 1 0 - 2 椿ビル 4 F 村上・大久保特許事務所
【氏名又は名称】	村上 友一

## 【選任した代理人】

【識別番号】	100086922
【住所又は居所】	東京都豊島区西池袋 5 - 1 0 - 2 椿ビル 4 F 村上・大久保特許事務所
【氏名又は名称】	大久保 操



特願 2 0 0 3 - 1 7 1 1 9 5

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[ 0 0 0 0 0 2 3 6 9 ]

1. 変更年月日

1 9 9 0 年 8 月 2 0 日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都新宿区西新宿 2 丁目 4 番 1 号

氏 名

セイコーエプソン株式会社